Diario Oficial

IMPO



Año CVII - Nº 28.399 | Montevideo, miércoles 25 de enero de 2012

energías renovables y alternativas

2012: AÑO INTERNACIONAL DE LA ENERGÍA SOSTENIBLE PARA TODOS



Presenta:

TNU Noticias Mediodía por PANTALLA IMPO

con audio por Diamante FM (98.7)

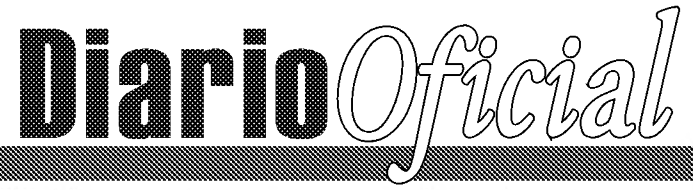
De lunes a viernes, al mediodía (12.30 a 13 hs), en el corazón de la ciudad de Montevideo, Pantalla IMPO emite TNU Noticias Mediodía con audio por Diamante FM (98.7).

Toda la información nacional e internacional de la mano del equipo de profesionales de la televisión de todos los uruguayos. Un aporte de IMPO al derecho ciudadano a la información, la comunicación y la cultura.

Gestión de Proyectos y Comunicación
Tel. 29085042 - Int. 353 - comunicacion@impo.com.uy

IMPO





REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

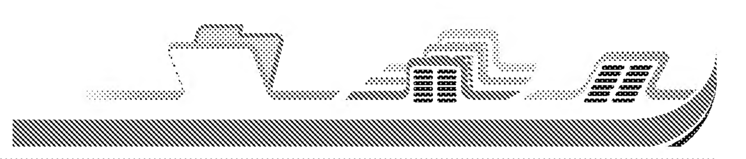
Año CVII - Nº 28.399 - Montevideo, miércoles 25 de enero de 2012

AVISOS

DOCUMENTOS

PODER EJECUTIVO
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES





Editado por la Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales - IM.P.O.
Av. 18 de Julio 1373, Montevideo, Uruguay / Tels. 2908 5042 – 2908 5276 – 2908 5180 – 2908 4923 / www.impo.com.uy / impo@impo.com.uy.

DIRECTOR GENERAL: Sr. Gonzalo Reboledo (greboledo@impo.com.uy)
GERENTE GENERAL: Cr. Héctor Tacón Ambroa (htacon@impo.com.uy)
DIRECTORES DE ÁREA: *Administración:* Cr. Mauricio Gargano (mgargano@impo.com.uy) – *Producción:* Sr. Héctor López Millot (hlopez@impo.com.uy)
Difusión y comercialización: Sr. Álvaro Rak (arak@impo.com.uy) – *Banco de datos:* Esc. Mónica Camerlati (mcamerlati@impo.com.uy) – *Servicios de apoyo:* Sr. Hugo Pereyra.
SECTORES: *Avisos* (avisos@impo.com.uy) – *Documentos* (documentos@impo.com.uy) – *Procesos de Edición* (proedicion@impo.com.uy)
Expedición y Stock (expedicion@impo.com.uy) – *Productos y Servicios* (informaciones@impo.com.uy) – *Gestión de Proyectos y Comunicación* (comunicacion@impo.com.uy)
CENTRO DE CÓMPUTOS: Datalogic Ingenieros S.R.L. (computos@impo.com.uy).
IMPRESIÓN: TRADINCO S.A. (Licitación Pública Nº 02/11)
Dep. Leg. 357.643 - Edición amparada en el Dec. Nº 218/996 - Comisión del Papel

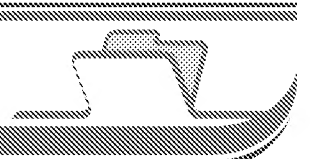

de la República Oriental del Uruguay

Miembro de la Red de Diarios Oficiales Americanos





DOCUMENTOS



PODER EJECUTIVO
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1

Decreto 500/011

Apruébase el Nonagésimo Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica Nº 18, que incorpora la Directiva Nº 07/11 de la Comisión de Comercio del MERCOSUR, relativa a "Adecuación de Requisitos Específicos de Origen".

(134*R)

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA
MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA

Montevideo, 27 de Diciembre de 2011

VISTO: el Nonagésimo Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica Nº 18, suscrito el 12 de octubre de 2011 entre los Gobiernos de la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, Estados Partes del MERCOSUR, al amparo de las disposiciones establecidas en el Tratado de Montevideo de 1980;

RESULTANDO: I) que en el mismo se incorpora al Acuerdo de Complementación Económica Nº 18, la Directiva Nº 07/11 relativa a "Adecuación de Requisitos Específicos de Origen", aprobada por la Comisión de Comercio del MERCOSUR, el 19 de mayo de 2011;

II) que es necesario actualizar los requisitos específicos de origen del Régimen de Origen del MEROCSUR para los Bienes de Informática y Telecomunicaciones;

III) que resulta conveniente adoptar medidas transitorias con vistas a agilizar la entrada en vigor de los requisitos de origen para facilitar la operativa comercial entre los Estados Partes;

IV) que la Directiva CCM Nº 07/11 tiene por objeto modificar el Apéndice I de la Decisión CMC Nº 01/09, conforme consta en los Anexos I y II que forman parte de dicha Directiva;

V) que la citada protocolización fue realizada conforme a lo previsto en el artículo 4 de la Directiva CCM Nº 07/11;

CONSIDERANDO: I) que de acuerdo a lo previsto en el artículo 2 del mencionado Protocolo, éste entrará en vigor 30 días después de la notificación de la Secretaría General de la ALADI a los países signatarios de que recibió la comunicación de la Secretaría del MERCOSUR, informando la incorporación de la norma MERCOSUR y de su correspondiente Protocolo Adicional a los ordenamientos jurídicos de los cuatro Estados Partes del MERCOSUR;

II) que de acuerdo a lo previsto en el artículo 3 de dicho Protocolo Adicional, una vez que éste entre en vigor, modificará el Anexo al Sexagésimo Segundo Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica Nº 18 -Anexo I de la Directiva CCM Nº 10/07-, y el Anexo al Septuagésimo Séptimo Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica Nº 18 -Apéndice I de la Decisión CMC Nº 01/09, derogará el Octogésimo Primero y el Octogésimo Segundo Protocolos Adicionales al Acuerdo de Complementación Económica Nº 18;

III) que a los efectos referidos precedentemente, corresponde incorporar al ordenamiento jurídico interno, el Nonagésimo Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica Nº 18;

ATENTO: a lo informado por la Delegación Permanente de la República Oriental del Uruguay ante ALADI y MERCOSUR.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- Apruébase el Nonagésimo Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica Nº 18, suscrito el 12 de octubre de 2011 entre los Gobiernos de la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, Estados Partes del MERCOSUR, que consta como anexo y forma parte del presente Decreto, y por el cual se incorpora al Acuerdo de Complementación Económica Nº 18, al amparo de las disposiciones establecidas en el Tratado de Montevideo de 1980, la Directiva Nº 07/11 de la Comisión de Comercio del MERCOSUR relativa a "Adecuación de Requisitos Específicos de Origen."

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese y dése cuenta a la Asamblea General.

JOSÉ MUJICA, Presidente de la República; LUIS ALMAGRO; FERNANDO LORENZO; ROBERTO KRIMERMAN; DANIEL GARÍN.

ACUERDO DE COMPLEMENTACION ECONÓMICA Nº 18 CELEBRADO ENTRE ARGENTINA, BRASIL, PARAGUAY Y URUGUAY

Nonagésimo Protocolo Adicional

Los Plenipotenciarios de la República Argentina, de la República Federativa del Brasil, de la República del Paraguay y de la República Oriental del Uruguay, acreditados por sus respectivos Gobiernos, según poderes otorgados en buena y debida forma, depositados oportunamente en la Secretaría General de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI),

TENIENDO EN CUENTA el Décimo Octavo Protocolo Adicional al ACE 18 y la Resolución GMC Nº 43/03,

CONVIENEN:

Artículo 1º - Incorporar al Acuerdo de Complementación Económica Nº 18 la Directiva Nº 07/11 de la Comisión de Comercio del MERCOSUR relativa a "Adecuación de Requisitos Específicos de Origen", que consta como Anexo e integra el presente Protocolo.

Artículo 2º - El presente Protocolo entrará en vigor 30 días después de la notificación de la Secretaría General de la ALADI a los países signatarios de que recibió la comunicación de la Secretaría del MERCOSUR, informando la incorporación de la norma MERCOSUR

y de su correspondiente Protocolo Adicional a los ordenamientos jurídicos de los cuatro Estados Partes del MERCOSUR.

La Secretaría General de la ALADI deberá efectuar dicha notificación, en lo posible, el mismo día de recibida la comunicación de la Secretaría del MERCOSUR.

Artículo 3º - Una vez en vigor, el presente Protocolo modificará el Anexo al Sexagésimo Segundo Protocolo Adicional al ACE Nº 18 -Anexo I de la Directiva CCM Nº 10/07-, y el Anexo al Septuagésimo Séptimo Protocolo Adicional al ACE Nº 18 -Apéndice I de la Decisión CMC Nº 01/09; y derogará el Octogésimo Primer y el Octogésimo Segundo Protocolos Adicionales al Acuerdo de Complementación Económica Nº 18.

La Secretaría General de la ALADI será depositaria del presente Protocolo, del cual enviará copias debidamente autenticadas a los Gobiernos de los países signatarios y a la Secretaría del MERCOSUR.

EN FÉ DE LO CUAL, los respectivos Plenipotenciarios firman el presente Protocolo en la ciudad de Montevideo, a los doce días del mes de octubre del año dos mil once, en un original en los idiomas español y portugués, siendo ambos textos igualmente válidos.

Por el Gobierno de la República Argentina: Daniel Raimondi.
Por el Gobierno de la República Federativa del Brasil: Otávio Brandelli.
Por el Gobierno de la República del Paraguay: Alejandro Hamed Franco.
Por el Gobierno de la República Oriental del Uruguay: Gonzalo Rodríguez Gigena.

ANEXO

SECRETARÍA DEL MERCOSUR
RESOLUCIÓN GMC Nº 26/01 – ARTÍCULO 10
FE DE ERRATAS - ORIGINAL – 11/08/11

Agustín Colombo Sierra
Director

MERCOSUR/CCM/DIR Nº 07/11

ADECUACION DE REQUISITOS ESPECIFICOS DE ORIGEN

VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto, las Decisiones Nº 08/03 y 01/09 del Consejo del Mercado Común, las Resoluciones Nº 29/10, 30/10 y 47/10 del Grupo Mercado Común y las Directivas Nº 10/07, 21/09 y 22/09 de la Comisión de Comercio del MERCOSUR.

CONSIDERANDO:

Que el Régimen de Origen MERCOSUR faculta a la Comisión de Comercio del MERCOSUR a modificar dicho Régimen por medio de Directivas.

Que es necesario adecuar los requisitos específicos de origen del Régimen de Origen del MERCOSUR a las modificaciones en la Nomenclatura Común del MERCOSUR.

Que es necesario actualizar los requisitos específicos de origen del Régimen de Origen del MERCOSUR para los Bienes de Informática y Telecomunicaciones.

Que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 2 de la Decisión CMC Nº 08/03, "mientras una norma que derogue una o más normas anteriores no entre en vigencia de acuerdo con el Artículo 40 del Protocolo de Ouro Preto, continuarán vigentes las normas anteriores que pretendan derogarse, siempre que hubieren sido incorporadas por los cuatro Estados Partes"

Que en función de ello, resulta conveniente adoptar medidas transitorias con vistas a agilizar la entrada en vigencia de los requisitos de origen para facilitar la operativa comercial entre los Estados Partes.

LA COMISIÓN DE COMERCIO DEL MERCOSUR
APRUEBA LA SIGUIENTE DIRECTIVA:

Art. 1 – Modifícase el Apéndice I de la Decisión CMC Nº 01/09, conforme consta en los Anexos I y II que forman parte de la presente Directiva.

Art. 2 - Hasta tanto la Decisión CMC Nº 01/09 entre en vigencia, las modificaciones establecidas en el Artículo 1º se aplicarán al Anexo I de la Directiva CCM Nº 10/07, donde corresponda.

Art. 3 - Deróganse las Directivas CCM Nº 21/09 y Nº 22/09.

Art. 4 – Solicítase a los Estados Partes que instruyan a sus respectivas Representaciones ante la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), a protocolizar la presente Directiva en el marco del Acuerdo de Complementación Económica Nº 18, en los términos establecidos en la Resolución GMC Nº 43/03.

Art. 5 – Esta Directiva deberá ser incorporada al ordenamiento jurídico de los Estados Partes antes del 31/X/2011.

CXX CCM – Montevideo, 19/V/11

ANEXO I

a) Incorporar al listado:

NCM2007	REQUISITO DE ORIGEN
2102.10.10	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
2102.10.90	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
5603.11.20	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
5603.11.30	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
5603.11.40	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
5603.12.30	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
5603.12.40	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
5603.12.50	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
5603.13.30	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
5603.13.40	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
5603.13.50	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
5603.14.20	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
5603.14.30	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
5603.14.40	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
5603.91.10	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
5603.91.20	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
5603.91.30	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
5603.91.90	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
5603.92.20	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
5603.92.30	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
5603.92.40	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
5603.93.20	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
5603.93.30	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
5603.93.40	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
5603.94.10	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
5603.94.20	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
5603.94.30	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional



5603.94.90	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
7304.51.11	Deberán ser producidos a partir de productos incluidos en la posición 7206 ó 7207 ó 7218 ó 7224, fundidos y moldeados o colados en los Estados Partes.
7304.51.19	Deberán ser producidos a partir de productos incluidos en la posición 7206 ó 7207 ó 7218 ó 7224, fundidos y moldeados o colados en los Estados Partes.
9006.10.10	60% de valor agregado regional.
9006.10.90	60% de valor agregado regional.

b) Eliminar del listado:

NCM2007	REQUISITO DE ORIGEN
2102.10.00	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
5603.91.00	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
5603.94.00	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
7304.51.10	Deberán ser producidos a partir de productos incluidos en la posición 7206 ó 7207 ó 7218 ó 7224, fundidos y moldeados o colados en los Estados Partes..
9006.10.00	60% de valor agregado regional.

ANEXO II

a) Sustituir del listado:

NCM 2007	DONDE DICE:	DEBE DECIR:
	REQUISITO DE ORIGEN	REQUISITO DE ORIGEN
8443.32.21	Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem “A” y “B” anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de “facsímil” de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem “A” y “B”. No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8443.32.22	Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem “A” y “B” anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de “facsímil” de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem “A” y “B”. No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8443.32.23	Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem “A” y “B” anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de “facsímil” de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem “A” y “B”. No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.

8443.32.29	Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8443.32.35	Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8443.32.39	Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8443.32.51	Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.

8443.32.59	Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8470.50.11	Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8470.50.19	Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8471.30.12	MICROCOMPUTADORAS PORTÁTILES: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso que implementen las funciones de procesamiento y memoria, las controladoras de periféricos para teclado, y unidades de discos magnéticos y las interfases de comunicación en serie y paralela acumulativamente. Cuando las unidades centrales de procesamiento incorporen en el mismo cuerpo o gabinete, placas de circuito impreso que implementen las funciones de red local o emulación de terminal, estas placas también deberán tener el montaje y soldadura de todos sus componentes; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores.Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Pantalla ("display") de los ítem 8473.30.91 y 8473.30.92; y 2) Teclado del ítem 8471.60.52. No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.-	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.

8471.30.19	MICROCOMPUTADORAS PORTÁTILES: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso que implementen las funciones de procesamiento y memoria, las controladoras de periféricos para teclado, y unidades de discos magnéticos y las interfases de comunicación en serie y paralela acumulativamente. Cuando las unidades centrales de procesamiento incorporen en el mismo cuerpo o gabinete, placas de circuito impreso que implementen las funciones de red local o emulación de terminal, estas placas también deberán tener el montaje y soldadura de todos sus componentes; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores.Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Pantalla ("display") de los ítem 8473.30.91 y 8473.30.92; y 2) Teclado del ítem 8471.60.52. No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.-	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8471.30.90	Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso;B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B. No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8471.41.90	Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso;B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B. No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8471.50.10	UNIDADES DIGITALES DE PROCESAMIENTO DE PEQUEÑA CAPACIDAD. Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso que implementan las funciones de procesamiento y memoria y las siguientes interfases: en serie, paralela, de unidades de discos magnéticos, de teclado y de video, acumulativamente. Cuando las unidades centrales de procesamiento incorporen en el mismo cuerpo o gabinete placas de circuito impreso que implementen las funciones de red local o emulación de terminal, estas placas también deberán tener un montaje y soldadura de todos los componentes. B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" e "B" anteriores. No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. En las unidades digitales de procesamiento del tipo "discless", destinadas a interconexión en redes locales, el montaje de la placa que implementa la interfase de red local podrá sustituir el montaje de las placas que implementan las interfases en serie, paralela y de unidades de discos magnéticos;	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.

8471.50.20	UNIDADES DIGITALES DE CAPACIDAD MEDIANA Y GRANDE. Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en el conjunto de placas de circuito impreso que implementen como mínimo 3 (tres) de las 5 (cinco) siguientes funciones: a) procesamiento central; b) memoria; c) unidad de control integrada/interfase o controladoras de periféricos; d) soporte y diagnóstico de sistema; e) canal o interfase de comunicación con unidad de entrada y salida de datos y periféricos; o, alternativamente, el montaje de por lo menos 4 (cuatro) placas de circuito impreso que implementen cualquiera de estas funciones; B. Montaje e integración de las placas de circuito impreso y de los conjuntos eléctricos y mecánicos en la formación del producto final; y C. Cuando el montaje del producto se realice con conjuntos en forma de cajón, estos conjuntos deberán ser montados a partir de sus subconjuntos, tales como: fuentes de alimentación, placas de circuito impreso y cables. Cuando la empresa opte por el montaje del número de placas de circuito impreso, establecido en el ítem "A", en caso de que se utilice placas que sean padrones del mercado, como por ejemplo, placas de memoria del tipo "SIMM" del ítem 8473.30.42 o 8473.50.50, se considerará una placa por función, independientemente de la cantidad de placas montadas para implementar la función. Para cumplir con lo dispuesto se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A", "B" y "C". Lo dispuesto en este Régimen, también se aplica a las unidades de control de periféricos, tales como controladores de discos, cintas, impresoras y lectoras ópticas y/o magnéticas y las expansiones de las funciones mencionadas en el ítem "A", incluso cuando no se presenten en el mismo cuerpo o gabinete de las unidades digitales de procesamiento.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8471.50.30	UNIDADES DIGITALES DE CAPACIDAD MEDIANA Y GRANDE. Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en el conjunto de placas de circuito impreso que implementen como mínimo 3 (tres) de las 5 (cinco) siguientes funciones: a) procesamiento central; b) memoria; c) unidad de control integrada/interfase o controladoras de periféricos; d) soporte y diagnóstico de sistema; e) canal o interfase de comunicación con unidad de entrada y salida de datos y periféricos; o, alternativamente, el montaje de por lo menos 4 (cuatro) placas de circuito impreso que implementen cualquiera de estas funciones; B. Montaje e integración de las placas de circuito impreso y de los conjuntos eléctricos y mecánicos en la formación del producto final; y C. Cuando el montaje del producto se realice con conjuntos en forma de cajón, estos conjuntos deberán ser montados a partir de sus subconjuntos, tales como: fuentes de alimentación, placas de circuito impreso y cables. Cuando la empresa opte por el montaje del número de placas de circuito impreso, establecido en el ítem "A", en caso de que se utilice placas que sean padrones del mercado, como por ejemplo, placas de memoria del tipo "SIMM" del ítem 8473.30.42 o 8473.50.50, se considerará una placa por función, independientemente de la cantidad de placas montadas para implementar la función. Para cumplir con lo dispuesto se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A", "B" y "C". Lo dispuesto en este Régimen, también se aplica a las unidades de control de periféricos, tales como controladores de discos, cintas, impresoras y lectoras ópticas y/o magnéticas y las expansiones de las funciones mencionadas en el ítem "A", incluso cuando no se presenten en el mismo cuerpo o gabinete de las unidades digitales de procesamiento.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8471.50.40	UNIDADES DIGITALES DE CAPACIDAD MUY GRANDE. Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en el conjunto de placas de circuito impreso que implementen por lo menos 2 (dos) de las 5 (cinco) siguientes funciones: a) procesamiento central; b) memoria c) unidad de control integrada/interfase; d) soporte y diagnóstico de sistemas; e) canal de comunicación, o alternativamente, el montaje de por lo menos 3 (tres) placas de circuito impreso que implementen cualquiera de estas funciones; B. Montaje e integración de las placas de circuito impreso y de los conjuntos eléctricos y mecánicos en la formación del producto final; y C. Cuando el montaje del producto se realice con conjuntos en forma de cajón, estos conjuntos deberán ser montados a partir de sus subconjuntos, tales como: fuentes de alimentación, placas de circuito impreso y cables. Cuando la empresa opte por el montaje del número de placas de circuito impreso establecido en el ítem "A", en caso de que se utilice placas que sean padrones de mercado, como por ejemplo, placas de memoria del tipo "SIMM", de los ítem 8473.30.42 o 8473.50.50, se considerará una placa por función, independientemente de la cantidad de placas montadas para implementar la función. Para cumplir con lo dispuesto se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A", "B" y "C". Lo dispuesto en este Régimen también se aplica a las unidades de control de periférico, tales como controladoras de discos, cintas, impresoras y lectoras ópticas y/o magnéticas y a las expansiones de las funciones mencionadas en el ítem "A", incluso cuando no se presenten en el mismo cuerpo o gabinete de las unidades digitales de procesamiento.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.

8471.50.90	Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8471.60.52	Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8471.60.53	Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8471.60.59	Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.

8471.60.61	Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8471.60.62	Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8471.60.80	Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8471.60.90	Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.

8471.70.12	DISCOS DUROS. Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B"; D. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B", y E. Para la producción de discos magnéticos duros con capacidad de almacenaje superior a 1 (un) GBYTES por HDA (Head Disk Assembly) no formateado, podrá optarse entre cumplir con lo dispuesto en los ítem "A" o "B" y en caso de cumplirse con lo dispuesto en el ítem "A" deberán ser soldados y montados todos los componentes en las placas de circuito impreso que implementen por lo menos dos de las siguientes funciones: a) comunicación con la unidad controladora de disco; b) posicionamiento de los conjuntos de lectura y grabación; c) o lectura y grabación.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8471.70.19	DISCOS DUROS. Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B"; D. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B", y E. Para la producción de discos magnéticos duros con capacidad de almacenaje superior a 1 (un) GBYTES por HDA (Head Disk Assembly) no formateado, podrá optarse entre cumplir con lo dispuesto en los ítem "A" o "B" y en caso de cumplirse con lo dispuesto en el ítem "A" deberán ser soldados y montados todos los componentes en las placas de circuito impreso que implementen por lo menos dos de las siguientes funciones: a) comunicación con la unidad controladora de disco; b) posicionamiento de los conjuntos de lectura y grabación; c) o lectura y grabación.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8471.70.39	Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8471.70.90	Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.

8471.80.00	Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8471.90.11	Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8471.90.12	Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8471.90.13	Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.

8471.90.19	Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8471.90.90	Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8472.90.10	Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8472.90.21	Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.



8472.90.29	Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8472.90.59	Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8473.29.10	CIRCUITOS IMPRESOS MONTADOS CON COMPONENTES ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS. Montaje y soldadura en las placas de circuito impreso de todos los componentes, siempre que estos no partan de la subpartida 8473.30.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso; II- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8473.30.41	CIRCUITOS IMPRESOS MONTADOS CON COMPONENTES ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS. Montaje y soldadura en las placas de circuito impreso de todos los componentes, siempre que estos no partan de la subpartida 8473.30.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso; II- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8473.30.42	PLACAS (MÓDULOS DE MEMORIA) CON UNA SUPERFICIE INFERIOR O IGUAL A 50 CM2. Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje de la pastilla semiconductora no encapsulada; B. Encapsulamiento de la pastilla; C. Test (ensayo) eléctrico; D. Marcación (identificación) del componente (memoria); y E. Montaje y soldadura de los componentes semiconductores (memoria) en el circuito impreso.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso; II- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8473.30.49	CIRCUITOS IMPRESOS MONTADOS CON COMPONENTES ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS. Montaje y soldadura en las placas de circuito impreso de todos los componentes, siempre que estos no partan de la subpartida 8473.30.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso; II- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8473.40.10	CIRCUITOS IMPRESOS MONTADOS CON COMPONENTES ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS. Montaje y soldadura en las placas de circuito impreso de todos los componentes, siempre que estos no partan de la subpartida 8473.30.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso; II- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8473.50.10	CIRCUITOS IMPRESOS MONTADOS CON COMPONENTES ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS. Montaje y soldadura en las placas de circuito impreso de todos los componentes, siempre que estos no partan de la subpartida 8473.30.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso; II- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8473.50.50	PLACAS (MÓDULOS DE MEMORIA) CON UNA SUPERFICIE INFERIOR O IGUAL A 50 CM2. Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje de la pastilla semiconductora no encapsulada; B. Encapsulamiento de la pastilla; C. Test (ensayo) eléctrico; D. Marcación (identificación) del componente (memoria); y E. Montaje y soldadura de los componentes semiconductores (memoria) en el circuito impreso.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso; II- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.

8511.80.30	Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8517.12.11	Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8517.12.12	Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8517.12.13	Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8517.12.19	Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8517.12.21	Cumplir con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8517.12.22	Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8517.12.23	Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.

8517.12.29	Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8517.12.31	Cumplir con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8517.12.33	Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8517.12.39	Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8517.12.41	Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8517.12.49	Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8517.12.90	Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8517.18.20	Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8517.61.11	Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.

8517.61.19	Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8517.61.20	Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8517.61.43	Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8517.61.49	Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8517.61.91	Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8517.61.92	Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8517.61.99	Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8517.62.11	Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8517.62.13	Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.

8517.62.14	Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8517.62.19	Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8517.62.21	Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8517.62.22	Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8517.62.23	Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8517.62.24	Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8517.62.29	Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8517.62.31	Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8517.62.32	Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.

8517.62.33	Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8517.62.41	Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8517.62.48	Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8517.62.51	Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8517.62.53	Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8517.62.55	Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8517.62.61	Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8517.62.62	Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8517.62.64	Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.



8517.62.65	Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8517.62.71	Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8517.62.72	Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8517.62.79	Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8517.62.91	Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8517.62.93	Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8517.62.94	Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8517.62.95	Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.

8517.62.96	Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8517.70.10	CIRCUITOS IMPRESOS MONTADOS CON COMPONENTES ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS. Montaje y soldadura en las placas de circuito impreso de todos los componentes, siempre que estos no partan de la subpartida 8473.30.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso; II- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8523.52.00	COMPONENTES SEMICONDUCTORES Y DISPOSITIVOS OPTOELECTRÓNICOS. Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje de la pastilla semiconductora no encapsulada; B. Encapsulamiento de la pastilla montada; C. Test (ensayo) eléctrico u optoelectrónico; D. Marcación (identificación); E. Los circuitos integrados bipolares con tecnología superior a cinco micrones (micra) y los diodos de potencia deberán también realizar el procesamiento físico-químico de la pastilla semiconductora; y F. Los circuitos integrados monolíticos proyectados en alguno de los Estados Partes están exentos de realizar las etapas "A" y "B" anteriores.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso; II- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8523.59.10	Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso; II- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8525.50.19	Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8525.50.29	Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8525.60.10	Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8525.60.90	Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.



8528.51.10	Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8528.51.20	Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8528.61.00	Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8529.90.12	CIRCUITOS IMPRESOS MONTADOS CON COMPONENTES ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS. Montaje y soldadura en las placas de circuito impreso de todos los componentes, siempre que estos no partan de la subpartida 8473.30.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso; II- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8531.20.00	Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.

8537.10.11	Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8537.10.19	Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8537.10.20	Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8543.70.12	Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8543.70.14	Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8543.70.15	Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.

8543.70.19	Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8543.70.39	Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8543.70.91	Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
9030.33.11	Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
9030.33.19	Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
9030.39.10	Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.

9030.40.10	Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
9030.40.20	Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
9030.40.30	Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
9030.40.90	Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.

9030.82.10	Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
9030.82.90	Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
9030.89.40	Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
9030.89.90	Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.

9030.90.90	Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
9031.80.40	Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
9032.89.11	Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
9032.89.21	Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.



9032.89.22	Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
9032.89.23	Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
9032.89.24	Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
9032.89.25	Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.

9032.89.29	Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
9032.89.81	Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
9032.89.82	Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
9032.89.83	Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.

9032.89.89	Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
9032.90.10	CIRCUITOS IMPRESOS MONTADOS CON COMPONENTES ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS. Montaje y soldadura en las placas de circuito impreso de todos los componentes, siempre que estos no partan de la subpartida 8473.30.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso; II- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.

b) incorporar al listado:

NCM 2007	REQUISITO DE ORIGEN
8443.31.11	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8443.31.12	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8443.31.13	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8443.31.14	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8443.31.15	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8443.31.16	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8443.31.19	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8443.31.91	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8443.31.99	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8443.32.31	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8443.32.32	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.

8443.32.33	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8443.32.34	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8443.32.36	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8443.32.37	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8443.32.40	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8443.32.52	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8443.32.91	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8443.32.99	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8443.99.60	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso; II- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8471.30.11	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8471.41.10	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8471.49.00	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8471.60.54	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8471.70.11	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8471.70.21	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8471.70.29	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8471.70.32	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8471.70.33	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.

8471.90.14	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8472.30.10	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8472.30.20	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8472.30.30	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8472.90.51	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8473.30.43	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso; II- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8517.12.32	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8517.61.30	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8517.61.41	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8517.61.42	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8517.62.12	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8517.62.39	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8517.62.49	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8517.62.52	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8517.62.54	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8517.62.59	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8517.62.77	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.

8517.62.78	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8517.62.92	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8517.69.00	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8528.71.11	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8538.90.10	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso; II- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.

c) eliminar del listado:

NCM 2007	REQUISITO DE ORIGEN
8443.31.00	60% de valor agregado regional.
8443.32.11	Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.
8443.32.12	Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.
8443.32.13	Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.
8443.32.19	Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.
8443.99.11	CIRCUITOS IMPRESOS MONTADOS CON COMPONENTES ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS. Montaje y soldadura en las placas de circuito impreso de todos los componentes, siempre que estos no partan de la subpartida 8473.30.
8443.99.13	Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.

8443.99.19	Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.
8443.99.21	Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.
8443.99.24	Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.
8443.99.31	60% de valor agregado regional.
8443.99.39	60% de valor agregado regional.
8473.29.90	Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.
8473.30.11	Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.
8473.30.19	Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.
8473.30.31	Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.
8473.30.39	Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.

8473.30.99	Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.
8473.50.32	Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.
8473.50.39	Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.
8473.50.90	Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.
8517.70.92	Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.
8517.70.99	Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.
8518.10.10	Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.
8518.29.10	Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.
8528.41.10	Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.

8528.41.20	Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.
8529.90.19	Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.
8540.50.20	Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.
8541.10.22	COMPONENTES SEMICONDUCTORES Y DISPOSITIVOS OPTOELECTRÓNICOS. Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje de la pastilla semiconductora no encapsulada; B. Encapsulamiento de la pastilla montada; C. Test (ensayo) eléctrico u optoelectrónico; D. Marcación (identificación); E. Los circuitos integrados bipolares con tecnología superior a cinco micrones (micra) y los diodos de potencia deberán también realizar el procesamiento físico-químico de la pastilla semiconductora; y F. Los circuitos integrados monolíticos proyectados en alguno de los Estados Partes están exentos de realizar las etapas "A" y "B" anteriores.
8541.10.29	COMPONENTES SEMICONDUCTORES Y DISPOSITIVOS OPTOELECTRÓNICOS. Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje de la pastilla semiconductora no encapsulada; B. Encapsulamiento de la pastilla montada; C. Test (ensayo) eléctrico u optoelectrónico; D. Marcación (identificación); E. Los circuitos integrados bipolares con tecnología superior a cinco micrones (micra) y los diodos de potencia deberán también realizar el procesamiento físico-químico de la pastilla semiconductora; y F. Los circuitos integrados monolíticos proyectados en alguno de los Estados Partes están exentos de realizar las etapas "A" y "B" anteriores.
8541.10.92	COMPONENTES SEMICONDUCTORES Y DISPOSITIVOS OPTOELECTRÓNICOS. Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje de la pastilla semiconductora no encapsulada; B. Encapsulamiento de la pastilla montada; C. Test (ensayo) eléctrico u optoelectrónico; D. Marcación (identificación); E. Los circuitos integrados bipolares con tecnología superior a cinco micrones (micra) y los diodos de potencia deberán también realizar el procesamiento físico-químico de la pastilla semiconductora; y F. Los circuitos integrados monolíticos proyectados en alguno de los Estados Partes están exentos de realizar las etapas "A" y "B" anteriores.
8541.10.99	COMPONENTES SEMICONDUCTORES Y DISPOSITIVOS OPTOELECTRÓNICOS. Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje de la pastilla semiconductora no encapsulada; B. Encapsulamiento de la pastilla montada; C. Test (ensayo) eléctrico u optoelectrónico; D. Marcación (identificación); E. Los circuitos integrados bipolares con tecnología superior a cinco micrones (micra) y los diodos de potencia deberán también realizar el procesamiento físico-químico de la pastilla semiconductora; y F. Los circuitos integrados monolíticos proyectados en alguno de los Estados Partes están exentos de realizar las etapas "A" y "B" anteriores.
8541.29.20	COMPONENTES SEMICONDUCTORES Y DISPOSITIVOS OPTOELECTRÓNICOS. Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje de la pastilla semiconductora no encapsulada; B. Encapsulamiento de la pastilla montada; C. Test (ensayo) eléctrico u optoelectrónico; D. Marcación (identificación); E. Los circuitos integrados bipolares con tecnología superior a cinco micrones (micra) y los diodos de potencia deberán también realizar el procesamiento físico-químico de la pastilla semiconductora; y F. Los circuitos integrados monolíticos proyectados en alguno de los Estados Partes están exentos de realizar las etapas "A" y "B" anteriores.
8541.30.21	COMPONENTES SEMICONDUCTORES Y DISPOSITIVOS OPTOELECTRÓNICOS. Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje de la pastilla semiconductora no encapsulada; B. Encapsulamiento de la pastilla montada; C. Test (ensayo) eléctrico u optoelectrónico; D. Marcación (identificación); E. Los circuitos integrados bipolares con tecnología superior a cinco micrones (micra) y los diodos de potencia deberán también realizar el procesamiento físico-químico de la pastilla semiconductora; y F. Los circuitos integrados monolíticos proyectados en alguno de los Estados Partes están exentos de realizar las etapas "A" y "B" anteriores.

8541.30.29	COMPONENTES SEMICONDUCTORES Y DISPOSITIVOS OPTOELECTRÓNICOS. Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje de la pastilla semiconductora no encapsulada; B. Encapsulamiento de la pastilla montada; C. Test (ensayo) eléctrico u optoelectrónico; D. Marcación (identificación); E. Los circuitos integrados bipolares con tecnología superior a cinco micrones (micra) y los diodos de potencia deberán también realizar el procesamiento físico-químico de la pastilla semiconductora; y F. Los circuitos integrados monolíticos proyectados en alguno de los Estados Partes están exentos de realizar las etapas "A" y "B" anteriores.
8541.40.16	COMPONENTES SEMICONDUCTORES Y DISPOSITIVOS OPTOELECTRÓNICOS. Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje de la pastilla semiconductora no encapsulada; B. Encapsulamiento de la pastilla montada; C. Test (ensayo) eléctrico u optoelectrónico; D. Marcación (identificación); E. Los circuitos integrados bipolares con tecnología superior a cinco micrones (micra) y los diodos de potencia deberán también realizar el procesamiento físico-químico de la pastilla semiconductora; y F. Los circuitos integrados monolíticos proyectados en alguno de los Estados Partes están exentos de realizar las etapas "A" y "B" anteriores.
8541.40.21	COMPONENTES SEMICONDUCTORES Y DISPOSITIVOS OPTOELECTRÓNICOS. Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje de la pastilla semiconductora no encapsulada; B. Encapsulamiento de la pastilla montada; C. Test (ensayo) eléctrico u optoelectrónico; D. Marcación (identificación); E. Los circuitos integrados bipolares con tecnología superior a cinco micrones (micra) y los diodos de potencia deberán también realizar el procesamiento físico-químico de la pastilla semiconductora; y F. Los circuitos integrados monolíticos proyectados en alguno de los Estados Partes están exentos de realizar las etapas "A" y "B" anteriores.
8541.40.22	COMPONENTES SEMICONDUCTORES Y DISPOSITIVOS OPTOELECTRÓNICOS. Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje de la pastilla semiconductora no encapsulada; B. Encapsulamiento de la pastilla montada; C. Test (ensayo) eléctrico u optoelectrónico; D. Marcación (identificación); E. Los circuitos integrados bipolares con tecnología superior a cinco micrones (micra) y los diodos de potencia deberán también realizar el procesamiento físico-químico de la pastilla semiconductora; y F. Los circuitos integrados monolíticos proyectados en alguno de los Estados Partes están exentos de realizar las etapas "A" y "B" anteriores.
8541.40.26	COMPONENTES SEMICONDUCTORES Y DISPOSITIVOS OPTOELECTRÓNICOS. Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje de la pastilla semiconductora no encapsulada; B. Encapsulamiento de la pastilla montada; C. Test (ensayo) eléctrico u optoelectrónico; D. Marcación (identificación); E. Los circuitos integrados bipolares con tecnología superior a cinco micrones (micra) y los diodos de potencia deberán también realizar el procesamiento físico-químico de la pastilla semiconductora; y F. Los circuitos integrados monolíticos proyectados en alguno de los Estados Partes están exentos de realizar las etapas "A" y "B" anteriores.
8541.40.31	CELULAS FOTOVOLTAICAS. Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Procesamiento físico-químico referente a etapas de división, texturización y metalización; B. Encapsulamiento de la pastilla montada; C. Test (ensayo) eléctrico u optoelectrónico; y D. Marcación (identificación).
8541.40.32	CELULAS FOTOVOLTAICAS. Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Procesamiento físico-químico referente a etapas de división, texturización y metalización; B. Encapsulamiento de la pastilla montada; C. Test (ensayo) eléctrico u optoelectrónico; y D. Marcación (identificación).
8541.50.20	COMPONENTES SEMICONDUCTORES Y DISPOSITIVOS OPTOELECTRÓNICOS. Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje de la pastilla semiconductora no encapsulada; B. Encapsulamiento de la pastilla montada; C. Test (ensayo) eléctrico u optoelectrónico; D. Marcación (identificación); E. Los circuitos integrados bipolares con tecnología superior a cinco micrones (micra) y los diodos de potencia deberán también realizar el procesamiento físico-químico de la pastilla semiconductora; y F. Los circuitos integrados monolíticos proyectados en alguno de los Estados Partes están exentos de realizar las etapas "A" y "B" anteriores.
8542.32.21	COMPONENTES SEMICONDUCTORES Y DISPOSITIVOS OPTOELECTRÓNICOS. Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje de la pastilla semiconductora no encapsulada; B. Encapsulamiento de la pastilla montada; C. Test (ensayo) eléctrico u optoelectrónico; D. Marcación (identificación); E. Los circuitos integrados bipolares con tecnología superior a cinco micrones (micra) y los diodos de potencia deberán también realizar el procesamiento físico-químico de la pastilla semiconductora; y F. Los circuitos integrados monolíticos proyectados en alguno de los Estados Partes están exentos de realizar las etapas "A" y "B" anteriores.
8542.32.29	COMPONENTES SEMICONDUCTORES Y DISPOSITIVOS OPTOELECTRÓNICOS. Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje de la pastilla semiconductora no encapsulada; B. Encapsulamiento de la pastilla montada; C. Test (ensayo) eléctrico u optoelectrónico; D. Marcación (identificación); E. Los circuitos integrados bipolares con tecnología superior a cinco micrones (micra) y los diodos de potencia deberán también realizar el procesamiento físico-químico de la pastilla semiconductora; y F. Los circuitos integrados monolíticos proyectados en alguno de los Estados Partes están exentos de realizar las etapas "A" y "B" anteriores.
8542.32.91	COMPONENTES SEMICONDUCTORES Y DISPOSITIVOS OPTOELECTRÓNICOS. Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje de la pastilla semiconductora no encapsulada; B. Encapsulamiento de la pastilla montada; C. Test (ensayo) eléctrico u optoelectrónico; D. Marcación (identificación); E. Los circuitos integrados bipolares con tecnología superior a cinco micrones (micra) y los diodos de potencia deberán también realizar el procesamiento físico-químico de la pastilla semiconductora; y F. Los circuitos integrados monolíticos proyectados en alguno de los Estados Partes están exentos de realizar las etapas "A" y "B" anteriores.
8542.33.90	COMPONENTES SEMICONDUCTORES Y DISPOSITIVOS OPTOELECTRÓNICOS. Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje de la pastilla semiconductora no encapsulada; B. Encapsulamiento de la pastilla montada; C. Test (ensayo) eléctrico u optoelectrónico; D. Marcación (identificación); E. Los circuitos integrados bipolares con tecnología superior a cinco micrones (micra) y los diodos de potencia deberán también realizar el procesamiento físico-químico de la pastilla semiconductora; y F. Los circuitos integrados monolíticos proyectados en alguno de los Estados Partes están exentos de realizar las etapas "A" y "B" anteriores.
8542.39.39	COMPONENTES SEMICONDUCTORES Y DISPOSITIVOS OPTOELECTRÓNICOS. Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje de la pastilla semiconductora no encapsulada; B. Encapsulamiento de la pastilla montada; C. Test (ensayo) eléctrico u optoelectrónico; D. Marcación (identificación); E. Los circuitos integrados bipolares con tecnología superior a cinco micrones (micra) y los diodos de potencia deberán también realizar el procesamiento físico-químico de la pastilla semiconductora; y F. Los circuitos integrados monolíticos proyectados en alguno de los Estados Partes están exentos de realizar las etapas "A" y "B" anteriores.



8542.39.99	COMPONENTES SEMICONDUCTORES Y DISPOSITIVOS OPTOELECTRÓNICOS. Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje de la pastilla semiconductora no encapsulada; B. Encapsulamiento de la pastilla montada; C. Test (ensayo) eléctrico u optoelectrónico; D. Marcación (identificación); E. Los circuitos integrados bipolares con tecnología superior a cinco micrones (micra) y los diodos de potencia deberán también realizar el procesamiento físico-químico de la pastilla semiconductora; y F. Los circuitos integrados monolíticos proyectados en alguno de los Estados Partes están exentos de realizar las etapas "A" y "B" anteriores.
8543.70.92	Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.
8543.70.99	Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.
8544.70.10	CABLES ÓPTICOS. Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Pintura de fibras; B. Reunión de fibras en grupos; C. Reunión para formación de núcleos; D. Extrusión de la capa o aplicación de armazón metálica y marcación; E. Se admitirá la realización de las actividades descriptas en los ítem "A" y "B" por terceros, siempre que se efectúe en uno de los Estados Partes; F. Las empresas deberán realizar actividades de ingeniería referentes al desarrollo y adaptación del producto a su fabricación y test (ensayos) de aceptación operativa; y G. Los cables ópticos deberán utilizar fibras ópticas que atiendan el requisito específico de origen definido para las mismas.
8544.70.30	CABLES ÓPTICOS. Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Pintura de fibras; B. Reunión de fibras en grupos; C. Reunión para formación de núcleos; D. Extrusión de la capa o aplicación de armazón metálica y marcación; E. Se admitirá la realización de las actividades descriptas en los ítem "A" y "B" por terceros, siempre que se efectúe en uno de los Estados Partes; F. Las empresas deberán realizar actividades de ingeniería referentes al desarrollo y adaptación del producto a su fabricación y test (ensayos) de aceptación operativa; y G. Los cables ópticos deberán utilizar fibras ópticas que atiendan el requisito específico de origen definido para las mismas.
8544.70.90	CABLES ÓPTICOS. Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Pintura de fibras; B. Reunión de fibras en grupos; C. Reunión para formación de núcleos; D. Extrusión de la capa o aplicación de armazón metálica y marcación; E. Se admitirá la realización de las actividades descriptas en los ítem "A" y "B" por terceros, siempre que se efectúe en uno de los Estados Partes; F. Las empresas deberán realizar actividades de ingeniería referentes al desarrollo y adaptación del producto a su fabricación y test (ensayos) de aceptación operativa; y G. Los cables ópticos deberán utilizar fibras ópticas que atiendan el requisito específico de origen definido para las mismas.
9001.10.11	FIBRAS ÓPTICAS. Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Procesamiento físico-químico que resulte en la obtención de la preforma; B. Estiramiento de la fibra; C. Test; D. Embalaje; E. Se admitirá la realización de la actividad descrita en el ítem "A" por terceros, siempre que se efectúe en uno de los Estados Partes; y F. Las empresas deberán realizar actividades de ingeniería referentes al desarrollo y adaptación del producto a su fabricación y test (ensayos).
9001.10.19	FIBRAS ÓPTICAS. Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Procesamiento físico-químico que resulte en la obtención de la preforma; B. Estiramiento de la fibra; C. Test; D. Embalaje; E. Se admitirá la realización de la actividad descrita en el ítem "A" por terceros, siempre que se efectúe en uno de los Estados Partes; y F. Las empresas deberán realizar actividades de ingeniería referentes al desarrollo y adaptación del producto a su fabricación y test (ensayos).
9001.10.20	CABLES ÓPTICOS. Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Pintura de fibras; B. Reunión de fibras en grupos; C. Reunión para formación de núcleos; D. Extrusión de la capa o aplicación de armazón metálica y marcación; E. Se admitirá la realización de las actividades descriptas en los ítem "A" y "B" por terceros, siempre que se efectúe en uno de los Estados Partes; F. Las empresas deberán realizar actividades de ingeniería referentes al desarrollo y adaptación del producto a su fabricación y test (ensayos) de aceptación operativa; y G. Los cables ópticos deberán utilizar fibras ópticas que atiendan el requisito específico de origen definido para las mismas.
9026.10.11	Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.
9028.30.11	Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.
9028.30.21	Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.

9028.30.31	Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsímil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.

2

Decreto 501/011

Apruébase el Nonagésimo Primer Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica Nº 18, que incorpora la Directiva Nº 05/11 de la Comisión de Comercio del MERCOSUR, relativa a "Regímenes Especiales de Importación".

(135*R)

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA
MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA

Montevideo, 27 de Diciembre de 2011

VISTO: el Nonagésimo Primer Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica Nº 18, suscrito el 12 de octubre de 2011 entre los Gobiernos de la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, Estados Partes del MERCOSUR, al amparo de las disposiciones establecidas en el Tratado de Montevideo de 1980;

RESULTANDO: I) que en el mismo se incorpora al Acuerdo de Complementación Económica Nº 18, la Directiva Nº 05/11 relativa a "Regímenes Especiales de Importación", aprobada por la Comisión de Comercio del MERCOSUR, el 03 de marzo de 2011;

II) que la Directiva CCM Nº 05/11 tiene por objeto adoptar para los Regímenes Especiales de Importación comprendidos en el Anexo de la Decisión CMC Nº 03/06, incluyendo los incorporados por las Directivas CCM Nº 12/06 y 31/09, la clasificación que consta en Anexo y forma parte de dicha Directiva;

III) que la citada protocolización fue realizada conforme a lo previsto en el artículo 4 de la Directiva CCM Nº 05/11;

CONSIDERANDO: I) que de acuerdo a lo previsto en el artículo 2 del mencionado Protocolo, éste entrará en vigor 30 días después de la notificación de la Secretaría General de la ALADI a los países signatarios de que recibió la comunicación de la Secretaría del MERCOSUR, informando la incorporación de la norma MERCOSUR y de su correspondiente Protocolo Adicional a los ordenamientos jurídicos de los cuatro Estados Partes del MERCOSUR;

II) que a los efectos referidos precedentemente, corresponde incorporar al ordenamiento jurídico interno, el Nonagésimo Primer Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica Nº 18;

ATENTO: a lo informado por la Delegación Permanente de la República Oriental del Uruguay ante ALADI y MERCOSUR.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- Apruébase el Nonagésimo Primer Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica Nº 18, suscrito el 12 de octubre de 2011 entre los Gobiernos de la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, Estados Partes del MERCOSUR, que consta como anexo y forma parte del presente Decreto, y por el cual se incorpora al Acuerdo de Complementación Económica Nº 18, al amparo de las disposiciones establecidas en el Tratado de Montevideo de 1980, la Directiva Nº 05/11 de la Comisión de Comercio del MERCOSUR relativa a "Regímenes Especiales de Importación."

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese y dése cuenta a la Asamblea General.
JOSÉ MUJICA, Presidente de la República; LUIS ALMAGRO; FERNANDO LORENZO; ROBERTO KREIMERMAN; DANIEL GARÍN.

ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA Nº 18 CELEBRADO ENTRE ARGENTINA, BRASIL, PARAGUAY Y URUGUAY

Nonagésimo Primer Protocolo Adicional

Los Plenipotenciarios de la República Argentina, de la República Federativa del Brasil, de la República del Paraguay y de la República Oriental del Uruguay, acreditados por sus respectivos Gobiernos, según poderes otorgados en buena y debida forma, depositados oportunamente en la Secretaría General de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI),

TENIENDO EN CUENTA el Décimo Octavo Protocolo Adicional al ACE 18 y la Resolución GMC Nº 43/03,

CONVIENEN:

Artículo 1º - Incorporar al Acuerdo de Complementación Económica Nº 18 la Directiva Nº 05/11 de la Comisión de Comercio del MERCOSUR relativa a "Regímenes Especiales de Importación", que consta como Anexo e integra el presente Protocolo.

Artículo 2º - El presente Protocolo entrará en vigor 30 días después de la notificación de la Secretaría General de la ALADI a los países signatarios de que recibió la comunicación de la Secretaria del MERCOSUR, informando la incorporación de la norma MERCOSUR y de su correspondiente Protocolo Adicional a los ordenamientos jurídicos de los cuatro Estados Partes del MERCOSUR.

La Secretaría General de la ALADI deberá efectuar dicha notificación, en lo posible, el mismo día de recibida la comunicación de la Secretaría del MERCOSUR.

La Secretaría General de la ALADI será depositaria del presente Protocolo, del cual enviará copias debidamente autenticadas a los Gobiernos de los países signatarios y a la Secretaría del MERCOSUR.

EN FÉ DE LO CUAL, los respectivos Plenipotenciarios firman el presente Protocolo en la ciudad de Montevideo, a los doce días del mes de octubre del año dos mil once, en un original en los idiomas español y portugués, siendo ambos textos igualmente válidos.

Por el Gobierno de la República Argentina: Daniel Raimondi.
Por el Gobierno de la República Federativa del Brasil: Otávio Brandelli.
Por el Gobierno de la República del Paraguay: Alejandro Hamed Franco.
Por el Gobierno de la República Oriental del Uruguay: Gonzalo Rodríguez Gigena.

ANEXO

MERCOSUR/CMC/DIR. Nº 05/11

REGÍMENES ESPECIALES DE IMPORTACIÓN

VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto, las Decisiones N° 69/00, 33/05, 03/06, 14/07 y 57/08 del Consejo del Mercado Común y las Directivas N° 12/06 y 31/09 de la Comisión de Comercio del Mercosur.

CONSIDERANDO:

Que el artículo 4° de Decisión CMC N° 33/05 encomendó la elaboración de una lista que contenga los regímenes nacionales de importación que podrán permanecer vigentes por razones tales como su impacto económico limitado o su finalidad no comercial.

Que en el Anexo de la Decisión CMC N° 03/06 se listaron los Regímenes Especiales de Importación adoptados unilateralmente por los Estados Partes del MERCOSUR con anterioridad al 30 de junio de 2000 y que cumplen con las condiciones establecidas en el artículo 4° de la Decisión CMC N° 33/05.

Que el artículo 6° de la Decisión CMC N° 03/06 determinó que los Estados Partes deberán informar a la CCM, en la segunda reunión del año los datos de comercio de las importaciones (discriminando posición arancelaria, volumen, valor FOB/CIF y origen) efectuadas al amparo de los regímenes que se listan en el Anexo de dicha Decisión, correspondientes al año anterior.

Que para ello, se instruyó al CT N° 2 a presentar una propuesta que permita la obtención de dicha información a través de la carga de los datos correspondientes a dichas importaciones, en los sistemas informáticos aduaneros de cada Estado Parte.

Que el CT N° 2 elaboró una clasificación de los regímenes en cuestión, distinguiendo tres grupos según la mayor o menor posibilidad de obtener la información comercial indicada en la Decisión CMC N° 03/06, de acuerdo al grado de informatización actualmente existente y a la naturaleza de cada régimen especial.

Que en virtud de dicha clasificación, resulta necesario establecer un criterio para el cumplimiento de la instrucción contenida en el artículo 6° de la Decisión CMC N° 03/06.

LA COMISIÓN DE COMERCIO DEL MERCOSUR APRUEBA LA SIGUIENTE DIRECTIVA:

Art. 1.- Adóptase para los Regímenes Especiales de Importación comprendidos en el Anexo de la Decisión CMC N° 03/06, incluyendo los incorporados por las Directivas CCM N° 12/06 y 31/09, la clasificación que consta en Anexo y forma parte de la presente Directiva.

Art. 2 - Los Estados Partes que a la fecha de entrada en vigencia de la presente Directiva no tengan informatizados los regímenes clasificados dentro de los Subgrupos B y C del Anexo, quedarán exceptuados de la exigencia del Artículo 6° de la Decisión CMC N° 03/06. En el caso de los regímenes clasificados como B se podrán presentar aquellos datos que resulten viables y se encuentren disponibles a través de los sistemas aduaneros actualmente vigentes.

Art. 3 - En la medida de los avances que pudieran ocurrir en la informatización de los regímenes citados precedentemente, los Estados Partes deberán informarlos en la última Reunión Anual Ordinaria de la CCM de cada año.

Art. 4.- Los Estados Partes deberán instruir a sus respectivas Representaciones ante la Asociación Latino-americana de Integración (ALADI) a protocolizar la presente Directiva en el ámbito del Acuerdo de Complementación Económica N° 18, en los términos establecidos en la Resolución GMC N° 43/03.

Art. 5.- Esta Directiva deberá se incorporada al ordenamiento jurídico de los Estados Partes antes del 01/VIII/11.

CXVIII CCM – Montevideo, 03/III/11.

ANEXO

Clasificación de los Regímenes Especiales de Importación incluidos en el Anexo de la Decisión CMC N° 03/06, incluyendo los incorporados por las Directivas CCM N° 12/06 y 31/09

* Subgrupo A: Regímenes que se encuentran informatizados y respecto de los cuales es posible brindar la información referida en el art. 6 de la Dec. CMC N° 03/06.
* Subgrupo B: Regímenes que se encuentran informatizados, pero por su naturaleza no comercial, no permiten obtener la totalidad de los datos solicitados
* Subgrupo C: Regímenes que no se encuentran informatizados en la actualidad y respecto de los cuales al no estar registrados a través de sistemas informáticos es complejo recabar cualquier tipo de datos.

REGIMENES ESPECIALES	SUB GRUPO		
Argentina	**A**	**B**	**C**
Régimen de envío de asistencia y salvamento Arts. 581 a 584 (CAA)		X	
Régimen de franquicias diplomáticas Arts. 529 a 549 (CAA)		X	
Medios de transporte de guerra, seguridad y policía Arts. 472 a 484 (CAA)		X	
Envíos de mercadería con deficiencias Arts. 573 a 577 (CAA)	X		
Régimen de envíos postales Arts. 550 a 559 (CAA)		X	X
Régimen de muestras Arts. 560 a 565 (CAA)	X		
Despacho de Oficio - Arts.429 a 436 (CAA)		X	
Régimen de tráfico fronterizo Arts. 578 a 580 (CAA)		X	
Obras de arte hechas a mano - Art. 4 de la Ley 24.633	X	X	
Mercaderías importadas en el marco de los acuerdos internacionales de Cooperación Técnica.		X	
Exención de (Derechos de Importación) para los Clubes - Ley N° 16.774 (derogado por Ley N° 20.545 desgravación por derechos de importación)	X		
Partidos Políticos – Ley N° 25.600 (derogada por Ley N° 26.215)		X	
Exención de derechos de importación a ferias y misiones comerciales.- Ley N° 20.545 (derogada por Ley N° 22.792)		X	
Bienes- enseñanza, investigación y salubridad. Decreto N° 732/72		X	

Reimportación de mercadería exportada para consumo. Arts. 566 a 572. Decreto 1001/82.	X		
Automotores para personas con discapacidad.		X	
Ley N° 24.805, referente a la construcción de acueductos en la Provincia de La Pampa	X		
Régimen de importación destinado a la rehabilitación, al tratamiento y la capacitación de las personas con discapacidad, establecido por la Resolución del ex Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos N° 1388/97, y su modificatoria		X	
Brasil	**A**	**B**	**C**
Régimen de envío de asistencia y salvamento		X	
Mercadería extranjera idéntica, en igual cantidad y valor, y que se destine a la reposición de otra anteriormente importada que haya resultado, con posterioridad al despacho aduanero, defectuosa o inservible para el fin al cual se destinaba.		X	
Envíos postales y encomienda aéreas internacionales, destinadas a personas físicas.			X
Mercadería extranjera que haya sido objeto de decomiso, excepto en caso de no haber sido localizada, haya sido consumida o revendida. (Ley N° 10.833/03 art. 77 y reglamento aduanero art. 73, inc III).		X	
Bienes traídos del exterior, en el marco del comercio característico de ciudades situadas en las fronteras terrestres (con terceros países exclusivamente)			X
Objetos de arte recibidos en donación, por museos (a importarse por entidades públicas autorizadas)		X	
Bienes importados al amparo de Acuerdos Internacionales de cooperación técnica, con tratamiento tributario previstos en los mismos.	X		
Partidos políticos e instituciones de educación o de asistencia social	X		
Mercaderías destinadas al consumo en el recinto de congresos, de ferias, exposiciones internacionales y de otros eventos internacionales similares			X
Libros, Diarios, Periódicos y el papel destinado a su impresión	X	X	X
Unión, Estados, Distrito Federal, Territorios, Municipios y sus respectivos entes autónomos y fundaciones	X		
Bienes destinados a fabricar urnas electrónicas de votos	X		
Equipos y material destinado, exclusivamente, al entrenamiento de atletas y a las competiciones deportivas relacionados con la preparación de los equipos brasileños para juegos olímpicos, paraolímpicos, panamericanos, parapanamericanos y mundiales	X		
Mercadería nacional o nacionalizada exportada que retorne al País: a) enviadas en consignación y no vendidas en los plazos autorizados; b) devuelta por motivo de defecto técnico, para reparación o para sustitución; c) por motivo de modificaciones en la sistemática de importación por parte del país importador; d) por motivo de guerra o de calamidad pública y e) por otros factores ajenos a la voluntad del exportador	X		
Muestras y envíos postales internacionales, sin valor comercial (Ley no 8.032, de 1990, art. 2°, inciso II, literal "b", y Ley n° 8.402, de 1992, art. 1°, inciso IV; artículo 15, DL N° 37/66)			X
Embarcaciones construidas en Brasil y transferidas por matriz de empresa brasileña de navegación para subsidiaria integral en el exterior, que retornen al registro brasileño, como propiedad de la misma empresa nacional de origen (Ley n° 9.432, del 8 de enero de 1997, art. 11, § 10)	X		
Misiones Diplomáticas, Reparticiones Consulares y representaciones de organismos internacionales, de carácter permanente, incluso los de ámbito regional, de los que Brasil sea miembro, y a los bienes de sus integrantes, incluidos los automotores (Ley no 8.032, de 1990, art. 2°, inciso I, literal "c", y Ley n° 8.402, de 1992, art. 1°, inciso IV y art. 140 del R. A. de Franquicias Diplomáticas			X
Paraguay	**A**	**B**	**C**
Tráfico Fronterizo. Sección 8. Art. 234, 235 y 236. Código Aduanero. Ley N° 2.422/04 (con terceros países exclusivamente)			X
Acuerdo de alcance parcial de cooperación y intercambio de bienes en las áreas cultural educacional y científica. Ley N° 367/94			X
Exoneración de Tributos a la Importación y Comercialización de libros, periódicos y revistas. Modifícase y amplíase la Ley N° 22 del 6 de Agosto de 1992. Ley N° 94/92	X		
Reembarque. Articulo 93 Ley 2422/04			X
Exención de Pago del Tributo por destrucción Total o Pérdida de Mercaderías. Art. N° 267. Código Aduanero. Ley N° 2.422/04			X
Exonera el pago de tributos las donaciones otorgadas a favor del Estado y Otras Instituciones y modifica el Art. 184 de la Ley N° 1.173/5. Ley N° 302/93. Decreto N° 6.359/05		X	
Ley N° 1095/84 art. 8 inmigrantes repatriados			X

3

Decreto 503/011

Apruébase el Octogésimo Séptimo Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica N° 18, que incorpora la Decisión N° 59/10 del Consejo del Mercado Común, relativa a "Regímenes Nacionales Especiales de Importación no contemplados en las Secciones VI y VII de la Decisión CMC N° 56/10".

(136*R)

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA
MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA

Montevideo, 30 de Diciembre de 2011

VISTO: el Octogésimo Séptimo Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica N° 18, suscrito el 28 de setiembre de 2011 entre los Gobiernos de la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, Estados Partes del MERCOSUR, al amparo de las disposiciones establecidas en el Tratado de Montevideo de 1980;

RESULTANDO: I) que en el mismo se incorpora al Acuerdo de Complementación Económica Nº 18, la Decisión Nº 59/10 relativa a "Regímenes Nacionales Especiales de Importación no contemplados en las Secciones VI y VII de la Decisión CMC Nº 56/10", aprobada por el Consejo del Mercado Común, el 16 de diciembre de 2010;

II) que la Decisión CMC Nº 59/10 tiene por objeto elevar a través del Grupo Mercado Común, una propuesta de tratamiento de otros regímenes nacionales especiales de importación no contemplados en las Secciones VI y VII de la Decisión CMC Nº 56/10 "Programa de Consolidación de la Unión Aduanera", a más tardar en la última Reunión Ordinaria de 2013;

III) que esta propuesta deberá contemplar un tratamiento a otorgar a los regímenes especiales de importación adoptados unilateralmente por los Estados Partes, que impliquen la exención total o parcial de los derechos aduaneros (Arancel Externo Común) que gravan la importación definitiva de mercaderías cuyo objetivo no sea el perfeccionamiento para posterior exportación de las mercaderías resultantes hacia terceros países, así como los beneficios concedidos al amparo de tales regímenes;

IV) que la citada protocolización fue realizada conforme a lo previsto en el artículo 8 de la Decisión CMC Nº 59/10;

CONSIDERANDO: I) que de acuerdo a lo previsto en el artículo 2 del mencionado Protocolo, éste entrará en vigor 30 días después de la notificación de la Secretaria General de la ALADI a los países signatarios de que recibió la comunicación de la Secretaría del MERCOSUR, informando la incorporación de la norma MERCOSUR y de su correspondiente Protocolo Adicional a los ordenamientos jurídicos de los cuatro Estados Partes del MERCOSUR;

II) que a los efectos referidos precedentemente, corresponde incorporar al ordenamiento jurídico interno, el Octogésimo Séptimo Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica Nº 18;

ATENTO: a lo informado por la Delegación Permanente de la República Oriental del Uruguay ante ALADI y MERCOSUR.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- Apruébase el Octogésimo Séptimo Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica Nº 18, suscrito el 28 de setiembre de 2011 entre los Gobiernos de la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, Estados Partes del MERCOSUR, que consta como anexo y forma parte del presente Decreto, y por el cual se incorpora al Acuerdo de Complementación Económica Nº 18, al amparo de las disposiciones establecidas en el Tratado de Montevideo de 1980, la Decisión Nº 59/10 del Consejo del Mercado Común relativa "Regímenes Nacionales Especiales de Importación no contemplados en las Secciones VI y VII de la Decisión CMC Nº 56/10".

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese y dése cuenta a la Asamblea General.
JOSÉ MUJICA, Presidente de la República; ROBERTO CONDE; FERNANDO LORENZO; EDGARDO ORTUÑO; TABARÉ AGUERRE.

ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA Nº 18 CELEBRADO ENTRE ARGENTINA, BRASIL, PARAGUAY Y URUGUAY

Octogésimo Séptimo Protocolo Adicional

Los Plenipotenciarios de la República Argentina, de la República Federativa del Brasil, de la República del Paraguay y de la República Oriental del Uruguay, acreditados por sus respectivos Gobiernos, según poderes otorgados en buena y debida forma, depositados oportunamente en la Secretaria General de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI),

TENIENDO EN CUENTA el Décimo Octavo Protocolo Adicional al ACE 18 y la Resolución GMC Nº 43/03,

CONVIENEN:

Artículo 1º - Incorporar al Acuerdo de Complementación Económica Nº 18 la Decisión Nº 59/10 del Consejo del Mercado Común relativa a "Regímenes Nacionales Especiales de Importación no contemplados en las Secciones VI y VII de la Decisión CMC Nº 56/10", que consta como Anexo e integra el presente Protocolo.

Artículo 2º - El presente Protocolo entrará en vigor 30 días después de la notificación de la Secretaría General de la ALADI a los países signatarios de que recibió la comunicación de la Secretaría del MERCOSUR, informando la incorporación de la norma MERCOSUR y de su correspondiente Protocolo Adicional a los ordenamientos jurídicos de los cuatro Estados Partes del MERCOSUR.

La Secretaría General de la ALADI deberá efectuar dicha notificación, en lo posible, el mismo día de recibida la comunicación de la Secretaría del MERCOSUR.

La Secretaría General de la ALADI será depositaria del presente Protocolo, del cual enviará copias debidamente autenticadas a los Gobiernos de los países signatarios y a la Secretaría del MERCOSUR.

EN FÉ DE LO CUAL, los respectivos Plenipotenciarios firman el presente Protocolo en la ciudad de Montevideo, a los veintiocho días del mes de setiembre del año dos mil once, en un original en los idiomas español y portugués, siendo ambos textos igualmente válidos.

Por el Gobierno de la República Argentina: Daniel Raimondi.
Por el Gobierno de la República Federativa del Brasil: Otávio Brandelli.
Por el Gobierno de la República del Paraguay: Alejandro Hamed Franco.
Por el Gobierno de la República Oriental del Uruguay: Gonzalo Rodríguez Gigena.

ANEXO

MERCOSUR/CMC/DEC. Nº 59/10

REGÍMENES NACIONALES ESPECIALES DE IMPORTACIÓN NO CONTEMPLADOS EN LAS SECCIONES VI y VII DE LA DECISIÓN CMC Nº 56/10

VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto y las Decisiones Nº 31/00, 69/00, 16/01, 32/03, 33/05, 02/06, 03/06, 14/07, 57/08 y 20/09 del Consejo del Mercado Común.

CONSIDERANDO:

Que la Decisión CMC Nº 69/00 dispone que los Estados Partes podrán establecer Regímenes Especiales Comunes de Importación para el MERCOSUR, determinando, por otro lado, la eliminación de los regímenes aduaneros especiales de importación adoptados unilateralmente por los Estados Partes.

Que la Decisión CMC Nº 02/06 estableció los sectores que deberán ser objeto de la elaboración de Regímenes Especiales Comunes de Importación.

Que es necesario establecer plazos adicionales a aquellos fijados en la Decisión CMC Nº 57/08 para que los Estados Partes concluyan las tareas tendientes a la armonización de los regímenes especiales de importación en el MERCOSUR y eliminen los regímenes nacionales adoptados unilateralmente.

Que la Decisión CMC Nº 20/09 prevé un tratamiento arancelario especial, en los casos de Paraguay y del Uruguay, para la importación

de insumos agropecuarios de extrazona, así como, en el caso de Paraguay, para la importación de materias primas.

EL CONSEJO DEL MERCADO COMÚN DECIDE:

Art. 1 – El Grupo Mercado Común elevará una propuesta de tratamiento de otros regímenes nacionales especiales de importación no contemplados en las Secciones VI y VII de la Decisión CMC Nº 56/10 "Programa de Consolidación de la Unión Aduanera", a más tardar en su última Reunión Ordinaria de 2013.

Art. 2 – La propuesta mencionada en el Artículo 1 deberá contemplar un tratamiento a otorgar a los regímenes especiales de importación adoptados unilateralmente por los Estados Partes, que impliquen la exención total o parcial de los derechos aduaneros (Arancel Externo Común) que gravan la importación definitiva de mercaderías cuyo objetivo no sea el perfeccionamiento para posterior exportación de las mercaderías resultantes hacia terceros países, así como los beneficios concedidos al amparo de tales regímenes.

Art. 3 – Los Artículos 1 y 2 no se aplican a los regímenes nacionales que podrán permanecer vigentes por razones de impacto económico limitado o finalidad no comercial, en los términos de la Decisión CMC Nº 03/06, ni tampoco a aquellos armonizados en el marco de la Decisión CMC Nº 02/06.

Art. 4 – Los Estados Partes notificarán a la Comisión de Comercio del MERCOSUR, a más tardar en el primer semestre de 2012, los regímenes especiales de importación a que se refieren los Artículos 1 y 2, exceptuados los regímenes mencionados en el Artículo 3.

4.1. Asimismo, notificarán anualmente a la Comisión de Comercio del MERCOSUR, a partir de 31 de enero de 2013, los regímenes de que trata la presente Decisión, independientemente de eventuales alteraciones introducidas en los mismos.

Art. 5 – Paraguay y Uruguay podrán aplicar, hasta 31 de diciembre de 2016, en la medida en que no utilicen regímenes de admisión temporal y "draw-back", una alícuota del 2% para la importación de insumos agropecuarios, de acuerdo con la lista de ítems arancelarios a ser notificados por cada Estado Parte a la Comisión de Comercio del MERCOSUR antes de 31 de diciembre de 2013.

Art. 6 – Crear, antes del 31 de diciembre de 2016, el régimen para la importación de materias primas para Paraguay, mediante el cual podrá importar insumos con una alícuota del 2%. La Comisión de Comercio del MERCOSUR elevará, antes de su última Reunión Ordinaria de 2013, una propuesta de mecanismo y las condiciones por las cuales Paraguay podrá utilizar el referido régimen.

6.1. Hasta la entrada en vigencia el régimen previsto en el presente Artículo y su reglamentación, se prorroga la vigencia de lo establecido en el Artículo 1 de la Decisión CMC Nº 32/03. Dicha prórroga no se extenderá más allá del 31 de diciembre de 2016.

Art. 7 – Paraguay y Uruguay notificarán los datos estadísticos correspondientes a la utilización de los regímenes mencionados en los Artículos 5 y 6 de acuerdo con las especificaciones y la frecuencia que determine la Comisión de Comercio del MERCOSUR, a más tardar antes de su tercera Reunión Ordinaria del primer semestre de 2011.

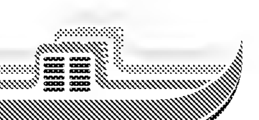
Art. 8 - Solicitar a los Estados Partes que instruyan a sus respectivas Representaciones ante la Asociación Latino Americana de Integración (ALADI) a protocolizar la presente Decisión en el ámbito del Acuerdo de Complementación Económica Nº 18, en los términos establecidos en la Resolución GMC Nº 43/03.

Art. 9 - Esta Decisión deberá ser incorporada al ordenamiento jurídico de los Estados Partes antes del 30/VI/2011.

XL CMC – Foz de Iguazú, 16/XII/10

AVISOS



Apertura de Sucesiones

Procesos sucesorios

PODER JUDICIAL

(Ley 16.044 Arts. 3o., 4o. y 5o.)
Los señores Jueces Letrados de Familia han dispuesto la apertura de las Sucesiones que se enuncian seguidamente y citan y emplazan a los herederos, acreedores y demás interesados en ellas, para que, dentro del término de TREINTA DÍAS, comparezcan a deducir en forma sus derechos ante la Sede correspondiente.

MONTEVIDEO

JUZGADO LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA DE FAMILIA

SEXTO TURNO

RINA GLADYS MENDEZ FERRERO (FICHA 2-12/2012).
Habilitado por Feria Judicial Mayor.
Montevideo, 17 de enero de 2012.
Esc. OLGA VAES TIRELLI, ACTUARIA ADJUNTA.
01) $ 2360 10/p 1126 Ene 20- Feb 02

Convocatorias

"EL PEÑASCAL S.A."
Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas:

Fecha: 15 de febrero de 2012.
Hora: 12:00. Primer convocatoria.
Hora: 14:00. Segunda convocatoria.
Lugar: Juncal 1305, Piso 14, Montevideo, Uruguay.
Orden del día:
1. Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea.
2. Obtención de financiamiento para los próximos 12 (doce) meses.
3. Designación de un accionista para la firma del Acta de Asamblea.
Aprobando lo actuado, se levanta la sesión de la fecha a la hora 14:30.-
EL DIRECTORIO.
Primera Publicación
03) $ 1065 3/p 1386 Ene 25- Ene 27

Elantir S.A

Convocase a la asamblea general extraordinaria de Elantir S.A para el día 6 del mes febrero del año 2012, a realizarse en la calle Treinta y Tres 1329 Piso 3º en primera convocatoria para las 14 horas y en segunda a las 15 horas, a fin de tratar los siguientes temas:
1) Informe sobre la probable demanda que realizará el accionista Pepe Gutiérrez y medidas preventivas de organización
2) Informe de la Arq. Gambini sobre las modificaciones al proyecto arquitectónico original transformándolo en otro que implique dos apartamentos por planta.
3) Informe sobre el trámite sobre compensación de mayor aprovechamiento ante la IMM según expediente Nº 6440/002638-11, y la cuota que corresponde al padrón Nº 124892.
Primera Publicación
03) $ 1278 3/p 1346 Ene 25- Ene 27



CONVOCATORIA A ELECCIONES

De acuerdo a lo resuelto en la Asamblea General Ordinaria de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Agrupación Magisterial "José Artigas" (COMAJA), realizada el 03 de diciembre de 2011 p.p., convoca a sus asociados al acto eleccionario para la elección de tres (3) integrantes del Consejo Directivo y dos (2) de la Comisión Fiscal de acuerdo al Artículo 62 del Estatuto Social y Ley 12.179, mediante voto secreto, por medio de listas separadas para el Consejo Directivo y la Comisión Fiscal.
Se ha fijado el mismo para el día 24 de febrero de 2012 en nuestro local de calle Lecueder Nº 269 de 09:00 a 17:00 horas, con una hora de prórroga si fuera necesario.
Las listas serán registradas y aceptadas por la Comisión Electoral hasta el día viernes 03 de febrero de 2012. (Art. 65 del Estatuto Social)
Saludamos muy atentamente
Ramón E. Yemini, Presidente; Marta Lima de Ferreira, Secretario.
Primera Publicación
03) $ 3124 4/p 1345 Ene 25- Ene 30

PILCOMAYO S. A.
CONVOCATORIA.

Por resolución del Directorio se convoca a Asamblea General Ordinaria el día 11 de febrero de 2012 a las 09:30 horas en primera convocatoria y a las 10:30 horas en segunda convocatoria local "COCINA" del edificio Planeta ubicado en Atlántida (Rambla y 22) con el fin de considerar los siguientes puntos del orden del Día.
1) Designación de Presidente y Secretario de Asamblea.
2) Designación de dos asambleistas para redactar y firmar Acta.
3) Consideración de la Memoria Anual. Balance General y Cuentas Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2011.
4) Designación del Directorio.
5) Designación del Síndico.
6) Deudores.
7) Comisión de estacionamiento.
8) Utilización del sector cocina: Parrilleros o salón para fiestas.
9) Utilización del parrillero abierto
10) Cobro por uso y limpieza de parrillero exterior, y parrilleros en cocina- salón.
11) Imposibilidad de uso de parrillero o cocina y demás instalaciones si hay más de un mes de deuda en gastos comunes.
12) Actualización máquinas para jardines desmalezadora.
13) Ver viabilidad de instalar ductos para riego en jardines con los terminales enterrados que suben por presión.
14) Poda de árboles y corte de troncos y eliminación de árboles con peligro de caída sobre linderos.
15) Secretario rentado o con viáticos.
16) Exoneración del pago de contribución inmobiliaria.
EL DIRECTORIO.
03) $ 2343 3/p 1286 Ene 24- Ene 26

Liga de Fomento de La Floresta
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Elecciones

Se convoca a los socios para la Asamblea Ordinaria y de renovación parcial de autoridades para el día 29 de Enero de 2012 a la hora 10.00 en primera convocatoria y a la hora 10.30 en segunda convocatoria, a realizarse en el local del Club Vivir de La Floresta, para tratar el siguiente orden del día:
1) Lectura y aprobacción del acta de Asamblea anterior
2) Consideración de memoria y balance de ejercicio cerrado el dia 30 de Noviembre 2011
3) Informe de Comisión Fiscal
4) Renovación parcial de autoridades
5) Designación de tres asambleistas para la firma del acta
Comisión Directiva.
Última Publicación
03) $ 1278 3/p 1225 Ene 23- Ene 25

CONVOCATORIA
FRIGORÍFICO TACUAREMBÓ S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que se celebrará el día 30 de enero de 2012, a las 12.00 horas en las Instalaciones del Frigorífico, en las intersecciones de las Rutas 5 y 26, Departamento de Tacuarembó, a efectos de considerar y resolver sobre el siguiente orden del día:
1. Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea.

2. Aprobación de Memoria y Balance del ejercicio cerrado al 30 setiembre de 2012; resolución sobre el destino de las utilidades.
3. Creación de una reserva por exoneración por inversiones.
4. Elección de Directorio.
5. Aprobación de lo actuado por el Directorio hasta la fecha.
6. Designación de un accionista para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
La presente convocatoria es realizada por el Directorio de acuerdo a lo establecido en el artículo 344 de la ley 16.060.
NOTA:
Para poder asistir a la Asamblea, los Accionistas deberán depositar sus acciones o certificados de depósito en el domicilio de la sociedad hasta dos días antes de la fecha en que se realizará la Asamblea. (Art. 35 de los Estatutos)
El Directorio.

Última Publicación

03) $ 2130 3/p 1205 Ene 23- Ene 25

CLUB DE LA PLAYA S.A..
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

1. Se convoca a los señores accionistas de Club de la Playa S.A. para la Asamblea General Ordinaria a realizarse a las 18 horas en primera convocatoria y a las 19 horas en segunda convocatoria el día 28 de enero del 2012 en el local de la Ruta 10 Km. 163, Balneario de Manantiales a los efectos de considerar el siguiente orden del día:
1) Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea.
2) Consideración de la Memoria, Balance General y Cuenta de Resultados al 31.10.11
3) Designación de Directorio
4) Designación de dos accionistas para firmar el acta
Se comunica a los señores accionistas que el Registro de Asistencia se cerrará en el momento de comenzar el acto.
El Directorio.

Última Publicación

03) $ 1491 3/p 1004 Ene 23- Ene 25

Dirección de Necrópolis

GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

INTENDENCIAS

INTENDENCIA DE CANELONES

Por disposición del Art. 22 Lit. c) de la Ordenanza de Necrópolis Nº 2763/80, se hace saber que: Robert Cristian, Visilfredo Bartolo y Dora Olga ALONZO BLANCO solicitan título Nicho Nº 33c Sector C del Cementerio de la ciudad de La Paz por regularización del mismo.-
En consecuencia se cita a todos los interesados que puedan acreditar derechos sobre el bien funerario para que comparezcan ante Dpto. Necrópolis de Municipio La Paz, estableciendo un plazo de 90 días a partir de la presente publicación.-
EXPTE. 2010-81-1211-00770.

04) $ 1775 5/p 1211 Ene 24- Ene 30

UNIDAD GESTION NECROPOLIS

Por disposición de la Ordenanza Nº 2763/80 de Necrópolis, Art. 22 Apdo. C Nral. 2º, se hace saber que los Sres.: Nuria Dolores NOVAS; Mario Raúl y María Cristina FABIANI NOVAS; Oriente y Olimpia FABIANI Y y Alda BIANCHI FABIANI.
Solicitan título del Nicho Nº 15 a- Sector C del Cementerio de la ciudad de La Paz, que figura en su frente "FABIANI" por carecer de título a su nombre.-
En consecuencia se cita a los interesados que puedan acreditar derechos sobre el bien funerario para que comparezcan ante el Dpto. de Necrópolis, del Municipio de La Paz, estableciendo un plazo de 90 días a partir de la presente publicación.-
Expte. 2009-81-1211-00324
Sr. Luis Pimienta.- Director de la Unidad Gestión Necrópolis.-
MARIO ESTEBAN
DIRECTOR DIVISION NECROPOLIS
CARGO Nº 148.

04) $ 2485 5/p 1149 Ene 23- Ene 27

Disoluciones de Sociedades Comerciales

RANGATE GROUP S.A.

Disolución anticipada y liquidación. Inscripción: 19/01/2012, Nº 730.

Única Publicación

06) $ 442 1/p 1347 Ene 25- Ene 25

Emplazamientos

PODER EJECUTIVO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

COMISIÓN ESPECIAL LEY Nº 18.596

"LA COMISIÓN ESPECIAL DE LA LEY 18.596 CONVOCA A LOS FAMILIARES HASTA 2º GRADO POR CONSANGUINIDAD (ABUELOS, PADRES, HERMANOS, HIJOS, NIETOS Y CÓNYUGE O CONCUBINA) DE LAS VÍCTIMAS:

*** GRISONAS ANDRIJAUSKAITE, Victoria Lucía (Exp. 2010-11-0001-3920)**

*** JULIEN CÁCERES, Mario Roger (Exp. 2010-11-0001-3920)**

A QUE COMPAREZCAN EN EL PLAZO DE 20 DÍAS A DEDUCIR EN FORMA SUS DERECHOS ANTE LA COMISIÓN ESPECIAL DE LA LEY 18.596, en cumplimiento del Decreto de fecha 1º de octubre de 2010.".

08) (Cta. Cte.) 10/p 775 Ene 16- Ene 27

GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

INTENDENCIAS

INTENDENCIA DE CANELONES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD GESTIÓN NECROPOLIS
EMPLAZAMIENTO

"Se intima a los herederos de María Anselma GUILLEN de CLAVIJO, titular del Nicho Nº 43 Sector H del Cementerio de la ciudad de Canelones o personas que se consideren con derecho sobre la citada propiedad funeraria, para que en un plazo de 90 días a partir de la presente publicación, se presenten con el título u otra documentación ante el Dpto. Necrópolis de la Comuna, bajo apercibimiento de que vencido éste, operará la caducidad de derechos en su concesión, por incumplimiento de las obligaciones de la Ordenanza de Necrópolis Nº 2763/80".-
Exp. 2010-81-1020-01475.

08) (Cta. Cte.) 5/p 1248 Ene 24- Ene 30

Incapacidades

PODER JUDICIAL

RÍO NEGRO

JUZGADO LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA DE YOUNG

SEGUNDO TURNO

EDICTO

Por disposición de la Sra. Juez Letrado de Primera Instancia de Segundo Turno de Young, en los autos: "PIAZZOLI VAN LOMMEL, CONRADO RUBEN. DECLARACION DE INCAPCIDAD Y NOMBRAMIENTO DE CURADOR." I.U.E. 445-63/2011, se hace saber que por RESOLUCION Nº 1 de fecha 3 de enero de 2012, se ha declarado en estado de incapacidad a CONRADO RUBEN PIAZZOLI VAN LOOMMEL, designándose como CURADORA del mismo a su esposa, SRA. MARLENE ELIZABETH AYALA, sirviendo esta providencia de suficiente discernimiento.- Se hace constar que se habilita la Feria Judicial Mayor a los efectos de estas publicaciones.- Young, 19 de enero del 2012.- Esc. Luisa Ma. Vico de Benedetti, Actuaria Adjunta.

Primera Publicación

10) $ 1800 10/p 1325 Ene 25- Feb 07

Licitaciones

ENTES AUTÓNOMOS

BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO - BSE



BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO

LICITACIÓN PUBLICA Nº 1.049.

OBJETO: LA CONTRATACION DE UNA EMPRESA PARA LA LIMPIEZA INTEGRAL DE EDIFICIOS OCUPADOS POR OFICINAS DEL BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO.
PLIEGOS: Los interesados podrán adquirir los pliegos de Condiciones Particulares en el Departamento de Compras Central, sito en Av. Libertador Brig. Gral. Lavalleja 1464, 1er. piso, Montevideo, todos los días hábiles de 12:00 a 17:00 horas.
COSTO DE LOS PLIEGOS: $ 3.000 (pesos uruguayos tres mil).
PROPUESTAS: Las mismas se recibirán hasta la hora de apertura de la Licitación.
APERTURA: La apertura de las propuestas se realizará el día 1º de marzo de 2012, a la hora 15:00, en el Salón de Actos, del edificio sito en Av. Libertador Brig. Gral. Lavalleja 1464, 1er. piso, Montevideo.
CONSULTAS: Se evacuan consultas por el Tel. 29 01 08 62, todos los días hábiles en el horario de 12:00 a 17:00 horas, o E-mail: ComprasConsultas@bse.com.uy.
PLIEGO: en la página WEB del Banco: www.bse.com.uy.
VISITA DE LOS LOCALES: 1). Se fija el día 17 de febrero, a la hora 9:00, a efectos de visitar: el Edificio Sede (Mercedes Nº 1051), oficinas anexas ubicadas en los edificios sitos en Av. Libertador Brigadier General Lavalleja 1458 y 1464, garage de Paraguay 1467, local de Mercedes 1085, y playa de estacionamiento, debiendo presentarse en el Sector Intendencia, Planta Baja del edificio Casa Central, con entrada por Av. Libertador 1465.
2). Se fija el día 15 de febrero, a la hora 12:00, a efectos de visitar los locales de: Washington 317, Reconquista 290, y Rambla República de Francia 291. con encuentro en el local de la calle Washington 317.
3). Se fija el día 16 de febrero, a la hora 10:00, a efectos de visitar el Edificio Sede de la División Reclamaciones (Automóviles), sito en Bulevar Artigas 3821 Esq. Burgues, debiendo presentarse en el Sector Personal, Planta Baja de dicho local.

Única Publicación

12) (Cta. Cte.) 1/p 1359 Ene 25- Ene 25

Edictos Matrimoniales

Montevideo, enero 25 de 2012
Cumplimiento de la disposición del artículo 3o. de la ley Nº 9.906 de 30 de diciembre de 1939 de acuerdo con lo que se expresa en dicho artículo debe tenerse muy en cuenta la advertencia que se transcribe que figura en los correspondientes edictos que firman los respectivos Oficiales del Registro Civil:
"En fe de lo cual intimo a los que supieren algún impedimento para el matrimonio proyectado lo denuncie por escrito ante esta Oficina haciendo conocer las causas y lo firme para que sea publicado en el "Diario Oficial" por espacio de ocho días como manda la ley."
Espacio limitado a tres días por la Ley Nº 9.906.

MONTEVIDEO

OFICINA No. 1

LUIS GABRIEL ARIAS, 35 años, soltero, fletero, oriental, domiciliado en Comodoro Coe 3439 y GIOVANA MARIANELA BAUZIL, 26 años, soltera, aux. enfermería, oriental, domiciliada en Comodoro Coe 3439.

Primera Publicación

14) $ 215 3/p 1340 Ene 25- Ene 27

FAUSTO RAFAEL DAVILA, 33 años, soltero, empleado, oriental, domiciliado en Boiso Lanza 4035/2 y JESSICA NOEMI DE LA CRUZ, 20 años, soltera, empleada, oriental, domiciliada en Boiso Lanza 4035/2.

Primera Publicación

14) $ 215 3/p 1329 Ene 25- Ene 27

VALENTIN DRAPER, 30 años, soltero, empleado, oriental, domiciliado en Bondpland 543/3 y MARIA PATRICIA TRIFOGLIO, 30 años, soltera, empleada, oriental, domiciliada en Bondpland 543/3.

Primera Publicación

14) $ 215 3/p 1318 Ene 25- Ene 27

MICHEL ALEXANDER APARICIO, 24 años, soltero, peón de construcción, oriental, domiciliado en La Boyada 2014 y EIDY NOEMY BENITEZ, 22 años, soltera, empleada, oriental, domiciliada en La Boyada 2014.

Primera Publicación

14) $ 215 3/p 1309 Ene 25- Ene 27

OFICINA No. 2

NICOLAS ALEJANDRO BAGATTINI, 35 años, soltero, médico, oriental, domiciliado en Narancio 3117 y ALEJANDRA LAURA BOTTA, 27 años, soltera, estudiante, oriental, domiciliada en Narancio 3117.

Primera Publicación

14) $ 215 3/p 1341 Ene 25- Ene 27

NICOLAS JUAN BRAUSE, 31 años, soltero, abogado, oriental, domiciliado en Zabala 1504 y MERCEDES GALEANO, 22 años, soltera, estudiante, oriental, domiciliada en Rivera 7137.

Primera Publicación

14) $ 215 3/p 1331 Ene 25- Ene 27

MARCELO ADRIAN BARCEL, 30 años, soltero, jornalero, oriental, domiciliado en Teniente Galeano Pasaje D Solar 11 Santo Dgo. Guzmán y XENIA DENISSE SAMPAYO, 32 años, soltera, labores, oriental, domiciliada en Teniente Galeano Pasaje D Solar 11 Santo Dgo. Guzmán.

Primera Publicación

14) $ 215 3/p 1330 Ene 25- Ene 27

OFICINA No. 3

RAUL ALBERTO CAMPERO, 48 años, divorciado, empleado, oriental, domiciliado en Solís Grande 937 Bis/2 y BLANCA ELIZABETH LEDESMA, 57 años, soltera, empleada, oriental, domiciliada en Solís Grande 937 Bis/2.

Primera Publicación

14) $ 215 3/p 1317 Ene 25- Ene 27

OFICINA No. 4

RAÚL FLORENTINO GONZÁLEZ, 95 años, viudo, jubilado, oriental, domiciliado en Besnes Yrigoyen 5347 y ANA MARÍA BRANDON, 56 años, soltera, empleada, oriental, domiciliada en Besnes Yrigoyen 5347.

Primera Publicación

14) $ 215 3/p 1338 Ene 25- Ene 27

LIBER ERNESTO LUNA, 40 años, divorciado, comerciante, oriental, domiciliado en 12 de Diciembre 1007 y MARÍA ALEJANDRA GUAGLIANONI, 36 años, soltera, empleada, oriental, domiciliada en 12 de Diciembre 1007.

Primera Publicación

14) $ 215 3/p 1319 Ene 25- Ene 27

HÉCTOR EDUARDO LEITE, 31 años, soltero, empleado, oriental, domiciliado en Salterain y Herrera 4577/3 e HILDA ADELINA NÚÑEZ, 26 años, divorciada, labores, oriental, domiciliada en Salterain y Herrera 4577/3.

Primera Publicación

14) $ 215 3/p 1316 Ene 25- Ene 27

MARTÍN LÓPEZ, 33 años, soltero, arquitecto, oriental, domiciliado en Feliciano Rodríguez 2675/5 y SIMARA BECERRA, 29 años, soltera, arquitecta, oriental, domiciliada en Feliciano Rodríguez 2675/5.

Primera Publicación

14) $ 215 3/p 1315 Ene 25- Ene 27

RICARDO WALTER LOSNO, 36 años, soltero, empleado, oriental, domiciliado en Rodó 2146/101 y CECILIA DAUBER, 27 años, soltera, docente, oriental, domiciliada en Rodó 2146/101.

Primera Publicación

14) $ 215 3/p 1310 Ene 25- Ene 27

OFICINA No. 5

JAVIER ALEJANDRO MEDINA, 28 años, soltero, empleado, oriental, domiciliado en Gral. Las Heras 1990/202 Montevideo e ILIANA PAYRA, 31 años, soltera, empleada, oriental, domiciliada en Gral. Las Heras 1990/202 Montevideo.

Primera Publicación

14) $ 215 3/p 1358 Ene 25- Ene 27

CIRO EDUARDO MEDINA, 79 años, divorciado, jubilado, oriental, domiciliado en Arquímedes 1151 Montevideo y ROSA FERNANDEZ VILLANUEVA, 78 años, divorciada, jubilada, oriental, domiciliada en Arquímedes 1151 Montevideo.

Primera Publicación

14) $ 215 3/p 1324 Ene 25- Ene 27

SEBASTIAN EDUARDO TASSINO, 28 años, soltero, lic. gestión agropecuaria, oriental, domiciliado en Andes1234/12 Montevideo y XIMENA ROJAS, 27 años, soltera, empleada, oriental, domiciliada en Andes1234/12 Montevideo.

Primera Publicación

14) $ 215 3/p 1323 Ene 25- Ene 27

JORGE MARIO OLIVERA, 43 años, soltero, empleado, oriental, domiciliado en Tupambaé 4996 Montevideo y ROSANA LAURA ROMBOLI, 45 años, soltera, empleada, oriental, domiciliada en Tupambaé 4996 Montevideo.

Primera Publicación

14) $ 215 3/p 1320 Ene 25- Ene 27

OFICINA No. 6

GONZALO JAVIER SANTANA, 26 años, soltero, empleado, oriental, domiciliado en Juan Paullier 1363 Ap. 2 y JACQUELINE EVELYN OSORIO, 25 años, soltera, empleada, oriental, domiciliada en Juan Paullier 1363 Ap. 2.

Primera Publicación

14) $ 215 3/p 1360 Ene 25- Ene 27

FEDERICO SARLI, 28 años, soltero, enfermero, oriental, domiciliado en Ramón Masini 3086 y VIRGINIA BARQUET, 30 años, soltera, médica, oriental, domiciliada en Ramón Masini 3086.

Primera Publicación

14) $ 215 3/p 1355 Ene 25- Ene 27

DENIS ADRIAN SOSA, 33 años, soltero, empleado, oriental, domiciliado en Thompson 3091/7 y ELIANA CLEMENTINO, 36 años, soltera, empleada, oriental, domiciliada en Thompson 3091/7.

Primera Publicación

14) $ 215 3/p 1348 Ene 25- Ene 27

ALFREDO ENRIQUE SPANGENBERG, 52 años, viudo, ingeniero civil, oriental, domiciliado en Vázquez Ledesma 2875 Ap. 401 e IRENE PAULA DELPONTE, 27 años, soltera, estudiante, argentina, domiciliada en Vázquez Ledesma 2875 Ap. 401.

Primera Publicación

14) $ 215 3/p 1344 Ene 25- Ene 27

SANTIAGO RODRIGUEZ, 30 años, soltero, empleado, oriental, domiciliado en Andresito Guacurarí 1824 y LUCIA LAURINO, 23 años, soltera, empleada, oriental, domiciliada en Andresito Guacurarí 1824.

Primera Publicación

14) $ 215 3/p 1321 Ene 25- Ene 27

OFICINA No. 7

GABRIEL NICOLAS PEREZ, 26 años, soltero, empleado, oriental, domiciliado en Carlos Nery 3676 Montevideo y PATRICIA CAROLINA FERNANDEZ, 31 años, soltera, empleada, oriental, domiciliada en Carlos Nery 3676 Montevideo.

Primera Publicación

14) $ 215 3/p 1362 Ene 25- Ene 27

FEDERICO ZYLBERGLAJT, 29 años, soltero, piloto, oriental, domiciliado en Benito Blanco 773/402 y MARIA PILAR PARGUIÑA, 29 años, soltera, empleada, oriental, domiciliada en Benito Blanco 773/402.

Primera Publicación

14) $ 215 3/p 1339 Ene 25- Ene 27

ALEXIS SEBASTIAN PERE, 28 años, soltero, empleado, oriental, domiciliado en Pastor 1059/3 y GABRIELA EDELAMA CORREA, 31 años, soltera, empleada, oriental, domiciliada en Pastor 1059/3.

Primera Publicación

14) $ 215 3/p 1322 Ene 25- Ene 27

Montevideo, enero 24 de 2012

Cumplimiento de la disposición del artículo 3o. de la ley Nº 9.906 de 30 de diciembre de 1939 de acuerdo con lo que se expresa en dicho artículo debe tenerse muy en cuenta la advertencia que se transcribe que figura en los correspondientes edictos que firman los respectivos Oficiales del Registro Civil:

"En fe de lo cual intimo a los que supieren algún impedimento para el matrimonio proyectado lo denuncie por escrito ante esta Oficina haciendo conocer las causas y lo firme para que sea publicado en el "Diario Oficial" por espacio de ocho días como manda la ley."

Espacio limitado a tres días por la Ley Nº 9.906.

MONTEVIDEO

OFICINA No. 1

GUSTAVO JAVIER ALVAREZ, 30 años, soltero, empleado, oriental, domiciliado en Con. Maldonado 7374 y CLAUDIA ANDREA LASSERRE, 29 años, soltera, escribana, oriental, domiciliada en Con. Maldonado 7374.

14) $ 215 3/p 1297 Ene 24- Ene 26

VICTOR EMANUEL AREVALO, 24 años, soltero, empleado, oriental, domiciliado en Pje. Madrid 7080 y MARIA GIMENA CAMARGO, 20 años, soltera, empleada, oriental, domiciliada en Sebastopol 5740 G.

14) $ 215 3/p 1214 Ene 24- Ene 26

OFICINA No. 2

MARCELO DANIEL BROCHADO, 31 años, soltero, procurador, oriental, domiciliado en Constituyente 1850/101 y MARIA JIMENA ACOSTA, 29 años, soltera, psicóloga, oriental, domiciliada en Constituyente 1850/101.

14) $ 215 3/p 1250 Ene 24- Ene 26

DANNY ROBERT FERNANDEZ, 33 años, soltero, chapista, oriental, domiciliado en Vecinal 6029 Paso de la Arena y LAURA PATRICIA GUTIERREZ, 29 años, soltera, esteticista, oriental, domiciliada en Inclusa 71.

14) $ 215 3/p 1238 Ene 24- Ene 26

ANTONIO ROBERTO FERRA, 73 años, viudo, jubilado, oriental, domiciliado en Misisippi 1536 Apto. B 402 y MARI CARMEN MAGGI, 57 años, divorciada, docente, oriental, domiciliada en Misisippi 1536 B Apto. 402.

14) $ 215 3/p 1235 Ene 24- Ene 26

LUIS EDUARDO BUKOWSKI, 51 años, soltero, empleado, oriental, domiciliado en Plácido Ellauri 3273 Bis Apto. 2 y CARMEN KARINA SALVARREY, 33 años, soltera, labores, oriental, domiciliada en Plácido Ellauri 3273 Bis Apto. 2.

14) $ 215 3/p 1233 Ene 24- Ene 26

IGNACIO BARRETO, 28 años, soltero, ingeniero en informática, oriental, domiciliado en Andrés Gómez 1776 Apto. 302 y LUCIA APEZTEGUIA, 29 años, soltera, médico, oriental, domiciliada en Andrés Gómez 1776 Apto. 302.

14) $ 215 3/p 1217 Ene 24- Ene 26

JULIO AARON BARBOZA, 35 años, soltero, abogado, oriental, domiciliado en Salvador Ferrer Serra 2124/11 y MARIA LOURDES RODRIGUEZ, 33 años, soltera, escribana, oriental, domiciliada en Salvador Ferrer Serra 2124/11.

14) $ 215 3/p 1198 Ene 24- Ene 26

OFICINA No. 3

SERGIO SEBASTIÁN CÁCERES, 27 años, soltero, empleado, oriental, domiciliado en Carlos A. López 8414/006 y YANIRA GISELL SMITH, 25 años, soltera, empleada, oriental, domiciliada en Carlos A. López 8414/006.

14) $ 215 3/p 1240 Ene 24- Ene 26



FABRIZIO DANTE CAVALIERI, 28 años, soltero, empleado, oriental, domiciliado en Cotagaita 300 y RITA NATALIA BALDISSERI, 27 años, soltera, empleada, oriental, domiciliada en Carlos María Ramírez 287.
14) $ 215 3/p 1221 Ene 24- Ene 26

MAURICIO JAVIER CARDOZO, 33 años, soltero, feriante, oriental, domiciliado en Juan Arteaga 3763 y NATALIA VANESSA GUTIERREZ, 31 años, soltera, empleada, oriental, domiciliada en Juan Arteaga 3763.
14) $ 215 3/p 1201 Ene 24- Ene 26

OFICINA No. 4

MARTÍN LOUSTAUNAU, 33 años, soltero, empleado, oriental, domiciliado en Manuel Pagola 3335/802 y CARINA de la FUENTE, 34 años, soltera, empleada, oriental, domiciliada en Joaquín Núñez 3041/4.
14) $ 215 3/p 1259 Ene 24- Ene 26

MARCOS FEDERICO LÓPEZ, 36 años, soltero, empleado, oriental, domiciliado en Andes 1371/201 y ANA CECILIA FERREIRA, 30 años, soltera, empleada, oriental, domiciliada en Andes 1371/201.
14) $ 215 3/p 1239 Ene 24- Ene 26

SERGIO NICOLÁS GRAMOSO, 21 años, soltero, empleado, oriental, domiciliado en Alianza 2181 y DEBORAH SOLANGE ALVEZ, 16 años, soltera, labores, oriental, domiciliada en Primera al Norte 035.
14) $ 215 3/p 1234 Ene 24- Ene 26

AITOR GALDONA, 33 años, soltero, empleado, brasileño N/U, domiciliado en Horacio Quiroga 6317 y MARIA PIA RETHEN, 32 años, soltera, médica, oriental, domiciliada en Horacio Quiroga 6317.
14) $ 215 3/p 1202 Ene 24- Ene 26

OFICINA No. 5

ANTONIO ALVARO MISEROCCHI, 28 años, soltero, empleado, oriental, domiciliado en Luis Surraco 2452/1 Montevideo y MARIA FLORENCIA FESTARI, 31 años, soltera, bioquímica, oriental, domiciliada en Luis Surraco 2452/1 Montevideo.
14) $ 215 3/p 1299 Ene 24- Ene 26

JAVIER DANIEL TABÓ, 25 años, soltero, empleado, oriental, domiciliado en Plaza Cagancha 1368/101 Montevideo y ANA PAULA PICABEA, 26 años, soltera, empleada, oriental, domiciliada en 18 de Julio 2045/701 Montevideo.
14) $ 215 3/p 1289 Ene 24- Ene 26

OFICINA No. 6

DIEGO GASTON ROBAINA, 33 años, soltero, abogado, oriental, domiciliado en José María Delgado 1854 Ap. 207 y PAOLA REFRESCHINI, 30 años, soltera, escribana, oriental, domiciliada en José María Delgado 1854 Ap. 207.
14) $ 215 3/p 1300 Ene 24- Ene 26

GONZALO RUSSO, 23 años, soltero, diseñador web, oriental, domiciliado en Gral. Luna 1261 y VALERIA DEVIA, 21 años, soltera, empleada, oriental, domiciliada en Los Robles 3084.
14) $ 215 3/p 1291 Ene 24- Ene 26

JAVIER APARICIO RODRIGUEZ, 32 años, soltero, empleado, oriental, domiciliado en Francisca Aznar de Artigas 6745 y MARIA FERNANDA DUARTE, 29 años, soltera, empleada, oriental, domiciliada en Francisca Aznar de Artigas 6745.
14) $ 215 3/p 1290 Ene 24- Ene 26

IGNACIO ROBAINA, 27 años, soltero, abogado, oriental, domiciliado en Joaquín Núñez 3026 y LUCIA ACLE, 27 años, soltera, psicopedagoga, oriental, domiciliada en Vázquez Ledesma 2969 Ap. 901.
14) $ 215 3/p 1271 Ene 24- Ene 26

OFICINA No. 7

NICOLAS AMARO CARVE, 37 años, soltero, empleado, oriental, domiciliado en Bartolito Mitre 2811/602 y MARIA CAROLINA LEMOS, 31 años, soltera, escribana, oriental, domiciliada en Bartolito Mitre 2811/602.
14) $ 215 3/p 1298 Ene 24- Ene 26

GASTON ALEXANDER VELAZQUEZ, 23 años, soltero, empleado, oriental, domiciliado en Liberia 128 Casabó y YESICA DAIANA DE PRATE, 24 años, soltera, labores, oriental, domiciliada en Cont. Burdeos 2685.
14) $ 215 3/p 1292 Ene 24- Ene 26

ARIEL SEBASTIAN PEDEMONTE, 30 años, soltero, veterinario, oriental, domiciliado en Santos 4960 y DIANA IRENE de BRUN, 31 años, soltera, empresaria, oriental, domiciliada en Santos 4960.
14) $ 215 3/p 1283 Ene 24- Ene 26

LUIS DANIEL PANIZA, 45 años, divorciado, chofer, oriental, domiciliado en Evaristo Ciganda 1216/2 y ANY KARINA BAGDASSARIAN, 38 años, soltera, abogada, oriental, domiciliada en Evaristo Ciganda 1216/2.
14) $ 215 3/p 1232 Ene 24- Ene 26

MARCOS LEONEL PEREYRA, 34 años, soltero, empleado, oriental, domiciliado en Juan Ramón Gómez 3124/3 y LORENA NINOSKA BALTRONS, 32 años, soltera, docente, oriental, domiciliada en Juan Ramón Gómez 3124/3.
14) $ 215 3/p 1200 Ene 24- Ene 26

Montevideo, enero 23 de 2012
Cumplimiento de la disposición del artículo 3o. de la ley Nº 9.906 de 30 de diciembre de 1939 de acuerdo con lo que se expresa en dicho artículo debe tenerse muy en cuenta la advertencia que se transcribe que figura en los correspondientes edictos que firman los respectivos Oficiales del Registro Civil:
"En fe de lo cual intimo a los que supieren algún impedimento para el matrimonio proyectado lo denuncie por escrito ante esta Oficina haciendo conocer las causas y lo firme para que sea publicado en el "Diario Oficial" por espacio de ocho días como manda la ley."
Espacio limitado a tres días por la Ley Nº 9.906.

MONTEVIDEO
OFICINA No. 1

CARLOS ALFREDO AGÜERO, 42 años, soltero, empleado, oriental, domiciliado en Pagola 1841 y ADRIANA LIZZIE OJEDA, 34 años, soltera, labores, oriental, domiciliada en Con Pagola 1841.
Última Publicación
14) $ 215 3/p 1140 Ene 23- Ene 25

FEDERICO MANUEL ARMESTO, 24 años, soltero, empleado, oriental, domiciliado en Gral. Palleja 2535/201 y LUCIANA MARIA DEPAULI, 27 años, soltera, enfermera, oriental, domiciliada en Gral. Palleja 2535/201.
Última Publicación
14) $ 215 3/p 1122 Ene 23- Ene 25

OFICINA No. 4

WASHINGTON MARCELO GÓMEZ, 39 años, soltero, docente, oriental, domiciliado en Av. Larrañaga 3737/313 y SUSANA MARINE LAVEGA, 39 años, soltera, docente, oriental, domiciliada en Av. Larrañaga 3737/313.
Última Publicación
14) $ 215 3/p 1152 Ene 23- Ene 25

SANTIAGO DANIEL LÓPEZ, 27 años, soltero, contador público, oriental, domiciliado en 18 de Diciembre 1561 y XIMENA SOMMER, 27 años, soltera, contadora pública, oriental, domiciliada en Julio César 1236 casa 4.
Última Publicación
14) $ 215 3/p 1135 Ene 23- Ene 25

JUAN IGNACIO GIOIA, 33 años, soltero, contador, oriental, domiciliado en Rivera 4790 y VIRGINIA RUTH AYALA, 38 años, soltera, arquitecta, oriental, domiciliada en Rivera 4790.
Última Publicación
14) $ 215 3/p 1125 Ene 23- Ene 25

OFICINA No. 5

MAXIMO GASTON MALDONADO, 36 años, soltero, psicólogo, oriental, domiciliado en Colonia 1810/202 Montevideo y NATALIA OLIVETTI, 28 años, soltera, médico, oriental, domiciliada en Colonia 1810/202 Montevideo.
Última Publicación
14) $ 215 3/p 1128 Ene 23- Ene 25

OFICINA No. 6

HEBERT RODRIGUEZ, 81 años, viudo, jubilado, oriental, domiciliado en Lepanto 1484 y ELPIDIA GOMEZ, 75 años, viuda, jubilada, paraguaya, domiciliada en Juan Medina 2178.
Última Publicación
14) $ 215 3/p 1151 Ene 23- Ene 25

DANTE LUIS SCARANO, 50 años, divorciado, empleado, oriental, domiciliado en San Martín 2665- 7 y LETICIA PEREIRA, 52 años, soltera, empleada, oriental, domiciliada en San Martín 2665- 7.
Última Publicación
14) $ 215 3/p 1150 Ene 23- Ene 25

OFICINA No. 7

JOSE CARLOS VIERA, 36 años, soltero, empleado, oriental, domiciliado en Pasaje Galicia 7014 Ap. 2 y MARIA del CARMEN ORDEIX, 21 años, soltera, labores, oriental, domiciliada en Pasaje Galicia 7014 Ap. 2.
Última Publicación
14) $ 215 3/p 1170 Ene 23- Ene 25

ROBERTO ANGEL VENTURA, 42 años, divorciado, empresario, oriental, domiciliado en Barroso 3857 y MARIA JOSE ARREGIN, 28 años, soltera, labores, oriental, domiciliada en Barroso 3857.

Última Publicación

14) $ 215 3/p 1148 Ene 23- Ene 25

GUILLERMO PALEO, 61 años, divorciado, jubilado, oriental, domiciliado en Enrique Muñoz 939 ap. 402 y MARIELA ELEONOR SALA, 52 años, divorciada, labores, oriental, domiciliada en Enrique Muñoz 939 ap. 402.

Última Publicación

14) $ 215 3/p 1137 Ene 23- Ene 25

Propiedad Literaria y Artística

BIBLIOTECA NACIONAL

REGISTRO DE DERECHOS DE AUTOR

Wellington Gabriel Mainero y José Ernesto Costa, solicitan la inscripción de la obra titulada: "LA HISTORIETA EN EL URUGUAY (UN VIAJE EN EL TIEMPO) 1890- 1955", investigación de la cual se declara autores.
Montevideo, 23 de enero de 2012.
Sr. Carlos Liscano
Director General.

Única Publicación

17) $ 120 1/p 1327 Ene 25- Ene 25

Sociedades de Responsabilidad Limitada

TRAIPI S.R.L.

Contrato: 18/01/2012
Inscripción Nro.: 839 el 20/01/2012
Socios: Guillermo FRANCO (5.000 cuotas), Martin CABRERA (5.000 cuotas)
Capital: $ 100.000
Objeto: A) Industrializar y comercializar en todas sus formas, mercaderías, arrendamientos de bienes, obras y servicios, en los ramos y anexos de: alimentación, artículos del hogar y oficina, bar, bazar, catering, cocina, comunicaciones, cosmética, cueros, deportes, enseñanza, frutos del país, hotel, música, obras de ingeniería, óptica, papel, perfumería, pesca, prensa, publicidad, química, radio, servicios profesionales, técnicos y administrativos, televisión, textil, transportes, turismo, valores mobiliarios, vestimenta, veterinaria y vidrio; B) Importaciones, exportaciones, representaciones, comisiones, y consignaciones; C) Compraventa, arrendamiento, administración, construcción y toda clase de operaciones con bienes inmuebles, E) Elaboración y comercialización de alimentos varios y servicio de catering, F) Participación, constitución o adquisición de empresas que operen en los ramos pre-indicados. En cumplimiento de dicho objeto la sociedad podrá realizar todo tipo de actos.
Plazo: 30 Años
Domicilio: Canelones
Administración: Indistinta.

Única Publicación

22) $ 3536 1/p 1409 Ene 25- Ene 25

URRUBEL S.R.L.

Contrato: 20/12/2011
Inscripción: Nro.: 20942 el 27/12/2011
Socios: Cristian Beltrame (5 cuotas), José Urrutia (5 cuotas)
Capital: $ 100.000
Objeto: Transporte profesional de Pasajeros y Turismo. En cumplimiento de dicho objeto la sociedad podrá realizar todo tipo de actos.
Plazo: 30 Años
Domicilio: Montevideo
Administración: José Urrutia.

Única Publicación

22) $ 1326 1/p 1391 Ene 25- Ene 25

ZOSIMA S.R.L.

Contrato: 19/01/2012
Inscripción Nro.: 912 el 23/01/2012
Socios: Maria MARZANO (10 cuotas), Maria MARZANO (10 cuotas)
Capital: $ 20.000
Objeto: Importación, confección y venta al por mayor y por menor de vestimenta, calzado, carteras y accesorios. Comercio en general. Exportación. En cumplimiento de dicho objeto la sociedad podrá realizar todo tipo de actos.
Plazo: 30 Años
Domicilio: Montevideo
Administración: Indistinta.

Única Publicación

22) $ 1768 1/p 1388 Ene 25- Ene 25

IST S.R.L.

Contrato: 28/12/2011.
Inscripción: Nº 65 (03/01/2012).
Socios/cuotas:
- Daniel BERRUTI (24).
- Leonardo RATAFIA (24).
- Gustavo OLIVERA SAGAS (12).

Capital: $ 120.000.
Objeto: Service y venta de productos y servicios de informática.
Administración: Indistinta.
Plazo: 30 años.
Domicilio: Montevideo.

Única Publicación

22) $ 884 1/p 1366 Ene 25- Ene 25

LEVARE S.R.L.

Constitución: 29/12/2011.
Inscripción: 144/04.01.2012.
Socios/cuotas:
- Egle DE BARROS PIAZZA (30).
- Gastón BRAGA DE BARROS (15).
- Omar BRAGA DE BARROS (Administrador) (15).

Objeto: Inversiones, excepto de intermediación financiera, en el país o exterior.
$ 60.000.
30 años.
Montevideo.

Única Publicación

22) $ 884 1/p 1364 Ene 25- Ene 25

MELIVER S.R.L.

Contrato: 15/12/2011. Insc. Nº 20542/2011
Socios/cuotas: Verónica Gisselle Capurro Lozano (33 cuotas), Ana Elizabeth Gajardo Rodríguez (33 cuotas) y Miriam Mabel Sellanes Tkachenko (34 cuotas).
Capital: $ 300.000.- dividido en 100 cuotas de $ 3.000.-
Objeto: Servicios de estética capilar y corporal, de manicuria, podología, masajes terapeúticos, reflexológicos, servicios de tratamientos no médicos, organización de eventos en general y especialmente relacionados con la estética; capacitación y asesoría en el ramo antes descripto.
Plazo: 30 años.
Administración: indistinta.
Domicilio: Montevideo.

Única Publicación

22) $ 1768 1/p 1363 Ene 25- Ene 25

PEB LUXURY FASHION LIMITADA

Contrato: 17/11/2011 Inscripción: 19186 29/11/11
Socios: PHILIPPE ETIENNE BRUNEAU (99 cuotas) y JULIANA ROSA ASIC (1 cuota)
Capital: $ 40.000 en 100 cuotas de $ 400 c/u
Plazo: 30 años. Domicilio: Montevideo
Objeto: prestar servicios, asesoramiento y desarrollo de venta en cosmética, venta, organización de eventos.
Administración: PHILIPPE BRUNEAU.

Única Publicación

22) $ 1326 1/p 1361 Ene 25- Ene 25

HG REPRESENTACIONES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA MODIFICACION

Fecha: 22/12/2011.
Inscripción: 20796/2011.
Modificacion: Administración: MARIA SOFIA DE CORES HELGUERA.

Única Publicación

22) $ 442 1/p 1343 Ene 25- Ene 25

"DANALIN S.R.L." CESION:

Contrato: 29/11/2011.
Inscripción: Nº 19.414, Año 2011.
Cedentes: Antonio AIROLA, 6 cuotas, y los hermanos Martín, Marianella, Diego y Gonzalo AGUIRRE, 6 cuotas.
Cesionarios: Gabriel JAUGE, 6 cuotas, y Gustavo JAUGE, 6 cuotas.
Precio: U$S- 67.500,- total.

Única Publicación

22) $ 884 1/p 1342 Ene 25- Ene 25

FERPEY SRL

Inscripción: Nº 19579 del 6 de diciembre de 2011.-
Socios: IGNACIO FERNANDEZ RUIZ y MATIAS PEYROU COLMEGNA
Capital: $ 100.000 (100 cuotas cada socio de $ 1.000).
Objeto: explotación de restaurantes, comidas al paso, pub, organización de espectáculos en general, de congresos u otros eventos, alojamiento en categoría de hostal, servicios y/o actividades anexas y afines.-

Plazo: 2 años, pudiendo prorrogarse por períodos iguales.-
Domicilio: Rocha.

Única Publicación

22) $ 1768 1/p 1332 Ene 25- Ene 25

EUBIOSIS S.R.L.
Cesión de cuotas sociales y Modificación de contrato social

Contrato: Mdeo, 28/12/2011
Inscripción: Nº 21155/2011
Cedentes: MANUEL HERNANDEZ GARCIA (1347 cuotas)
JUAN MANUEL RAVELO (1347 cuotas)
Cesionarias: Ethel Yaneth Lopetegui Wunsch (2647 cuotas)
Nllza Rene Wunsch (47 cuotas)
Administración: Ethel Janeth Lopetegui Wunsch, exclusivamente.

Única Publicación

22) $ 1326 1/p 1314 Ene 25- Ene 25

COLBAX S.R.L.
Cesión - Modificación

Contrato: 22/3/2011
Inscripción: Registro Comercio Nº 16049
Cedentes: CELSA GONZALEZ (93750 cuotas, 25%) y ANABELLA MONZILLO (128400 cuotas, 34,4%)
Cesionarios: Antonella y Federico Monzillo (133840 y 222150 cuotas, 35,69% y 23,55%)
Administración: Antonella, Federico y Anabella Monzillo.

Única Publicación

22) $ 1326 1/p 1313 Ene 25- Ene 25

CALSIX S.R.L.
Cesión - Modificación

Contrato: 20/3/2011
Inscripción: Registro Comercio Nº 8205
Cedentes: ANABELLA MONZILLO (371250 cuotas) y CELSA GONZALEZ (3750 cuotas)
Cesionarios: Antonella y Federico Monzillo (50% - 187500 cuotas c/u)
Administración: Anabella, Antonella y Miguel Monzillo.

Única Publicación

22) $ 884 1/p 1311 Ene 25- Ene 25

SRL

Denominación: TIERRA BUENA S.R.L.
Contrato: 10 agosto 2011 / 31 octubre 2011
Inscripción: Nº 15281 (27/9/2011)
Nº 19578 (06/12/2011)
Socios: JUAN JOSE PORRO POGGI
LUIS EDGARDO AMOZA BOZZOLO
50 cuotas de $ 1.000 c/u
Capital: $ 100.000
Plazo: 30 años
Administración: ambos socios en forma conjunta
Objeto: cualquier explotación agrícola, pecuaria o agropecuaria.
Industrializar, elaborar, comercializar mercaderías. Arrendamiento de bienes, obras y servicios. Compraventa, administración y operaciones con bienes muebles e inmuebles.
Importación. Exportación.
Domicilio: Paysandú.

Única Publicación

22) $ 1768 1/p 1308 Ene 25- Ene 25

LOS GUERREROS SRL

Contrato: Paysandú, 14-12-2011
Inscripción Nº 20330 de 16-12-2011
Socios: NORBERTO ANTONIO SPECIALE y SILVIA MARIA RUMIERI
Capital: $ 200.000
Cuotas: 100 de $ 2.000, correspondiendo 50 cuotas a cada socio.
Objeto: la industrialización, producción, comercialización, importación, exportación, representación y transporte de materias primas, mercaderías, bienes y servicios.
Plazo: 30 años
Domicilio: Paysandú.
Administración: en forma INDISTINTA por los socios NORBERTO ANTONIO SPECIALE y SILVIA MARIA RUMIERI.

Única Publicación

22) $ 1768 1/p 1307 Ene 25- Ene 25

BUPO AGROPECUARIA SRL

Contrato: Paysandú, 17-11-2011
Inscripción Nº 19594 de 6-12-2011
Socios: OSCAR HUMBERTO BUPO y ALEJANDRO ENRIQUE BERTRAN
Capital: $ 300.000
Cuotas: 100 de $ 3.000, correspondiendo 95 cuotas a OSCAR BUPO, y 5 a ALEJANDRO BERTRAN
Objeto: industrialización, producción, comercialización, importación, exportación, representación y transporte de materias primas, mercaderías, bienes y servicios.
Plazo: 30 años
Domicilio: Paysandú.
Administración: en forma INDISTINTA por los socios OSCAR HUMBERTO BUPO, y ALEJANDRO ENRIQUE BERTRAN.

Única Publicación

22) $ 1768 1/p 1306 Ene 25- Ene 25

ADINÉS S.R.L.

Contrato: 27/11/2011
Inscripción: Nº 19.133/2011
Socios: Estefanía Malo Castro, Luis Maximiliano Silva Sanchez (15 cuotas cada socio)
Objeto: Instituto de Enseñanza capacitación y educación, desarrollando cursos a nivel nacional; contrataciones con institutos privados y/o con el Estado, importación de material educativo.
Plazo: 30 años
Administración: Estefanía Malo Castro
Domicilio: Montevideo
Capital: $ 30.000.

Única Publicación

22) $ 1326 1/p 1088 Ene 25- Ene 25

Venta de Comercios

Llamado a Acreedores Ley Nro. 2.904 (26/9/1904)

Enajenante: SAFER S.R.L.
Adquirente: SAN ROQUE S.A.
Establecimiento comercial: "FARMACIA OROMAR" ubicado Rivera No. 202-A, entre Alvear y las Heras, San José de Carrasco.
Acreedores: presentarse en Cerrito 532 oficina 802 (Montevideo), de lunes a viernes de 10 a 17 horas, en el término legal.

25) $ 3420 20/p 39822 Dic 29- Ene 26

Venta de Comercio

Ley 2904. Verónica Inés Jara prometió vender a Adriana Antelo Vespa, establecimiento comercial "Salon Blues", sito en Uruguay 1030 bis. Acreedores allí.

25) $ 2280 20/p 39746 Dic 29- Ene 26

Ley 2.904. ERNESTO TIESO GIGLIO prometío vender a ÁNGELA DAYANA BAZZAN, Salón de Avda. General Aguilar 1254, Montevideo. Acreedores allí.

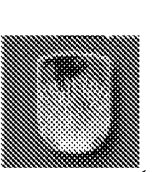
25) $ 1140 20/p 519 Ene 09- Feb 03

Varios

PODER EJECUTIVO

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA - DGI






SELECCIÓN DE CONSULTORES Nº DGI-000017-SCC
Programa Apoyo a la Gestión Tributaria
OBJETO: Producción de contenidos para el Portal de Educación Tributaria
Préstamo Nº 1783/OC-UR

La Dirección General de Impositiva (D.G.I.), ha recibido un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo para sufragar el costo del Programa Apoyo a la Gestión Tributaria y parte de los fondos de este financiamiento se destinarán a efectuar pagos elegibles que se lleven a cabo en virtud del Contrato de Consultoría, Nº de compra: DGI-000017-SCC-CONSULTORIA.
El objetivo general de la presente consultoría es la contratación de servicios para la producción de contenidos para el Portal de Educación Tributaria tales como videojuegos, gráficos interactivos e infografías, orientados a escolares y liceales de todas las edades.
El presupuesto estimado para la presente consultoría es de U$S 15.000 (Dólares Americanos quince mil).
La D.G.I. invita a presentar expresión de

interés para los servicios de ésta consultoría. Las firmas consultoras interesadas deberán presentar la documentación que la empresa estime necesaria para ser tomada en consideración para la confección de una lista corta de consultores. La presente invitación es extensiva a firmas con nacionalidad de un país miembro del Banco Interamericano de Desarrollo.
La información mínima a proporcionar por las firmas consultoras interesadas deberá comprender:
1. Información sobre la Firma Consultora
2. Experiencia en consultorías similares a nivel nacional e internacional en Organismos Estatales y empresas privadas, efectuando una breve descripción, duración, monto y fechas de ejecución del cada proyecto.
3. Breve descripción de la Metodología a utilizar
En la dirección indicada abajo, deberán ser entregadas personalmente hasta el día 23 de febrero de 2012 a la hora 11:00, 2 copias del documento titulado Expresión de Interés para Consultoría de firmas para la producción de contenidos para el Portal de Educación Tributaria, Nº de compra: DGI-000017-SCC-CONSULTORIA.
Los oferentes interesados podrán obtener el pliego de especificaciones técnicas, mediante solicitud escrita a:
Contacto:
Atención: Equipo Coordinador del Programa BID Nº 1783
Dirección: Avenida Daniel Fernández Crespo Nº 1534, Piso 8
Ciudad: Montevideo
Teléfono: (00598) 1344 interno 6584
Fax: (00598) 1344 internos 6584
Dirección de correo electrónico: bid1783@dgi.gub.uy.

Única Publicación

27) (Cta. Cte.) 1/p 1337 Ene 25- Ene 25

MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN NACIONAL DE AGUAS - DINAGUA





Se comunica que se ha presentado en esta Dirección Nacional una solicitud de BOISY S.A. para regularizar un represamiento que embalsa 1:100.000 m³ de aguas de una cañada, tributaria del Arroyo Yaguarí, afluente del Río Tacuarembó, en la cuenca del Río Negro, con destino al riego de cultivos de arroz. El dique de la represa y su embalse se ubican íntegramente en el padrón Nº 8.512, perteneciente a la 7ª sección catastral del departamento de Tacuarembó.-
Se cita a todos aquellos que tuvieren interés a una Audiencia Pública a efectuarse en las condiciones establecidas en el Art. 177 del Código de Aguas, el día 15 de febrero de 2012, a las 10:30 horas, en la oficina de la Dirección Nacional de Aguas de la ciudad de Tacuarembó, sita en la calle Gral. Rivera Nº 16.-
Ing. Agrim. Ramón L. Lluviera
Coordinador RRHH - Cuenca Río Negro
DINAGUA.

27) $ 2673 3/p 1223 Ene 24- Ene 26





Se comunica que se ha presentado en esta Dirección Nacional una solicitud de BOISY S.A., para regularizar un represamiento que embalsa 1:350.000 m³ de aguas de una cañada, tributaria del Arroyo Yaguarí, afluente del Río Tacuarembó, en la cuenca del Río Negro, con destino al riego de cultivos de arroz. El dique de la represa y su embalse se ubican íntegramente en el padrón Nº 14.270, perteneciente a la 7ª sección catastral del departamento de Tacuarembó.-
Se cita a todos aquellos que tuvieren interés a una Audiencia Pública a efectuarse en las condiciones establecidas en el Art. 177 del Código de Aguas, el día 15 de febrero de 2012, a las 11:30 horas, en la oficina de la Dirección Nacional de Aguas de la ciudad de Tacuarembó, sita en la calle Gral. Rivera Nº 16.-
Ing. Agrim. Ramón L. Lluviera
Coordinador RRHH - Cuenca Río Negro
DINAGUA.

27) $ 2673 3/p 1222 Ene 24- Ene 26

DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDIO AMBIENTE - DINAMA

Comunicación de Proyecto Viabilidad Ambiental de Localización MANIFIESTO

Se hace saber que se pone de manifiesto en las oficinas de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Galicia 1733, piso 2), por el término de 10 días hábiles (artículo 15 del Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto 349/05 del 21 de setiembre de 2005) a partir del día inmediato siguiente de la última publicación, la Comunicación de Viabilidad Ambiental de Localización presentada por ESTRELLADA S.A. del proyecto "PARQUE EÓLICO ARBOLITO" a instalarse en los padrones Nº 988, 6455, 13000, 16390, 16391, 16392, 16393, 16764, 16766, 16767 y 16768 de la 10ª Sección Judicial del Departamento de Cerro Largo, Paraje Arbolito. Se accede al proyecto desde el kilómetro 363 de la Ruta Nº 8, a unos 2 kilómetros al oeste. El proyecto incluye la instalación de 20 aerogeneradores con una potencia instalada de 50 MW. La Comunicación también se encuentra disponible en la página de internet de la Dirección Nacional de Medio Ambiente en el sitio:
www.mvotma gub.uy/dinama
Montevideo, 17 de enero de 2012.

Única Publicación

27) $ 810 1/p 1352 Ene 25- Ene 25

Comunicación de Proyecto Viabilidad Ambiental de Localización MANIFIESTO

Se hace saber que se pone de manifiesto en las oficinas de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Galicia 1133, piso 2), por el término de 10 días hábiles (artículo 15 del Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto 349/05 del 21 de setiembre de 2005) a partir del día inmediato siguiente de la última publicación, la Comunicación de Viabilidad Ambiental de Localización presentada por el HOSPITAL DR. ALFREDO VIDAL Y FUENTES del proyecto "PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS" a instalarse en los padrones Nº 2595 y 2580, zona urbana, de la 1ª Sección Judicial del Departamento de Lavalleja. La instalación se realizará en los mismos predios donde se encuentra el Hospital, en Avda. Varela 1185 de la ciudad de Minas. El proyecto incluye la instalación de la infraestructura para el tratamiento y neutralización de residuos sólidos hospitalarios (infecciosos y cortopunzantes). La Comunicación también se encuentra disponible en la página de internet de la Dirección Nacional de Medio Ambiente en el sitio:
www.dinama.gub.uy/
Montevideo, 17 de enero de 2012.

Única Publicación

27) $ 648 1/p 1351 Ene 25- Ene 25

ENTES AUTÓNOMOS

BANCO CENTRAL DEL URUGUAY - BCU



MESA DE NEGOCIACIONES
CAMBIOS Y ARBITRAJES DEL DIA

CIERRE DE OPERACIONES DEL DIA 20 de enero de 2012

PAISES	MONEDAS TRANSF.	COD.		ARBITRAJES	
	MERCADO DE CAMBIOS				
ARGENTINA	PESO ARGENTINO	0500		4,321700	
BRASIL	REAL	1000		1,757500	
INGLATERRA	LIBRA ESTERLINA	2700	U$S	1,554000	
JAPON	YEN	3600		76,975000	
SUIZA	FRANCO SUIZO	5900		0,934500	
UNION MONET. EURO	EURO	1111	U$S	1,293000	
	COTIZACIONES INTERBANCARIAS				
				COMPRA	**VENTA**
ARGENTINA	PESO ARG. BILLETE	0501	$	3,902	3,902
BRASIL	REAL BILLETE	1001	$	10,898	10,898



ESTADOS UNIDOS	DLS. USA BILLETE	2225	$	19,564	19,564
ESTADOS UNIDOS	DLS. USA CABLE	2224	$	19, 562	19,562
ESTADOS UNIDOS	DLS. USA FDO BCU	2223	$	19,562	19, 562

POR OTROS ARBITRAJES Y/O TASAS CONSULTAR A CENTRO COMUNICAC. INSTITUCIONAL TELEFAX: 19671690.

Única Publicación
27) (Cta. Cte.) 1/p 1367 Ene 25- Ene 25

BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL - BPS



Se confiere vista a los beneficiarios que se detallan a continuación de que, de acuerdo con el resultado de las actuaciones cumplidas en sus solicitudes de los subsidios que se indican, no se cumplen las exigencias legales para configurar el derecho a la prestación, por lo que se dictará resolución denegatoria.
C.I., Nombre, Expediente, Subsidio;
3.400.586-0, Evelyn Sotelo, 2011/1/106355, Desempleo;
1.708.841-5, Ma. Del Rosario Palleiro, 2011/1/64918, Desempleo;
1.323.809-0, Juan Grosso, 2011/1/21075, Desempleo;
1.265.470-2, Isabel Meriles, 2011/1/84814, Desempleo;
5.079.950-2, Nelson Gonzalez, 2011/1/3664, Desempleo;
4.147.695-9, Juan Elizalde, 2007/1/73303, Asig. Familiares.
Tramitación y Liquidaciones Activos
Gerencia Prestaciones Económicas - Montevideo.

Primera Publicación
27) (Cta. Cte.) 3/p 1336 Ene 25- Ene 27



Se notifica a los beneficiarios que se detallan a continuación, la Resolución denegatoria recaída en sus solicitudes de los subsidios que se indican.
C.I., Nombre, RES. Nº, Expediente, Subsidio;
4.915.858-3, María José Cardozo, 244/2011, 2011/1/71501, Desempleo;
2.959.396-3, Victoria Brundi, 140/2011, 2011/1/162713, Desempleo;
1.403.319-4, Acosta Tulio, 241/2011, 2009/1/132594, Desempleo.
Tramitación y Liquidación Activos
Gerencia Prestaciones Económicas - Montevideo.

Primera Publicación
27) (Cta. Cte.) 3/p 1335 Ene 25- Ene 27



Se cita a los Sucesores de Vicente Scabone, Reg. 1961146, a efectos de notificarse de resolución de Gerencia Adscripta a la Dirección Técnica nº RGA 70/2012 en Sarandí 570 1er Piso - Sección Mesa de Entrada - dentro del plazo de 30 días bajo apercibimiento de darlos por notificados de acuerdo a lo establecido por el art. 51 del Código Tributario.
Asesoría Tributaria y Recaudación - Montevideo.

Primera Publicación
27) (Cta. Cte.) 3/p 1334 Ene 25- Ene 27

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA - UDELAR

FACULTAD DE DERECHO

SECCIÓN CONCURSOS

CARTELERA No. 028/11
Llamar a aspirantes para la conformación de un orden de prelación a efectos de la designación interina de Asistentes (Grado 2) en la asignatura Comercialización Internacional de la Lic. en Relaciones Internacionales.
CARTELERA No. 029/11
Llamar a aspirantes para la conformación de un orden de prelación a efectos de la designación interina de Ayudante (Grado 1) en la asignatura Comercialización Internacional de la Lic. en Relaciones Internacionales.
CARTELERA No. 030/11
Llamar a aspirantes para la provisión en efectividad de un(1) cargo de Profesor Adjunto, (Grado 3), en la asignatura Historia de las Relaciones Internacionales de la Lic. en Relaciones Internacionales por un plazo inicial de dos años y con una dedicación mínima de 10 horas semanales.
APERTURA DE INSCRIPCIONES: Lunes 30 de Enero de 2012
VENCIMIENTO DEL PLAZO DE INSCRIPCIONES: - Viernes 30 de Marzo de 2012
LUGAR DE PRESENTACIÓN:
SECCIÓN CONCURSOS de la FACULTAD DE DERECHO, Avda. 18 de Julio 1824 Entrepiso de Planta Alta, en Montevideo y en SECCIÓN PERSONAL RECURSOS HUMANOS de la Regional Norte (Sede Salto), Avda. Rivera 1350 en el horario de lunes a viernes de 9.00 a 13.00 horas.
REQUISITOS: página Web - www.fder.edu.uy (Concursos y Llamados)
Por mayor información dirigirse a la Página Web: www.fder.edu.uy.

Única Publicación
27) (Cta. Cte.) 1/p 1357 Ene 25- Ene 25

SERVICIOS DESCENTRALIZADOS

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO - ASSE

CENTROS DEPARTAMENTALES DE SALUD PÚBLICA

CENTRO DEPARTAMENTAL DE RÍO NEGRO

Por la presente se cita al Dra. Laura Bacci a concurrir a la División de Investigaciones y Sumarios de A.S.S.E. a los efectos de otorgársele vista de la referencia número 068/1/1088/2004 al amparo del Art. 26 de la Ley 9202 de la Comisión Honoraria de Salud Pública, la que se expedirá como tribunal disciplinario.

Primera Publicación
27) $ 2430 10/p 1393 Ene 25- Feb 07

Por la presente se cita al Dr. Mauricio Vespa a concurrir a la División de Investigaciones y Sumarios de A.S.S.E. a los efectos de otorgársele vista de la referencia número 068/1/1088/2004 al amparo del Art. 26 de la Ley 9202 de la Comisión Honoraria de Salud Pública, la que se expedirá como tribunal disciplinario.

Primera Publicación
27) $ 2430 10/p 1392 Ene 25- Feb 07

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE PUERTOS - ANP

PUERTO DE MONTEVIDEO

FE DE ERRORES En la publicación realizada el día 5 de enero de 2012 sobre la solicitud de prórroga de los permisos de ocupación realizada por Lobraus Puerto Libre S.A, correspondiente al Depósito en Zona 1 y las áreas adyacentes de 4.155 m2 y de 1.393 m2. se padeció error al indicar el número de expediente de ANP, siendo el correcto 112096.

Única Publicación
27) (Cta. Cte.) 1/p 1356 Ene 25- Ene 25

PUERTO DE MONTEVIDEO

Se hace público que la empresa COMFRIG S.A. se presentó ante la Administración Nacional de Puertos, solicitando la renovación del permiso de explotación del Depósito Nº 11 y su área adyacente de 2.695 m2 en el Puerto de Montevideo, la ANP está dispuesta a acceder al petitorio por el plazo de un año y un canon de U$S 39.085 por mes, (Decreto 412/992 Art. 51 y 52). Los interesados deberán presentarse por escrito a la Unidad Reguladora de Trámite de la A.N.P. ubicada en el segundo piso del Edificio Sede en el horario de 9:00 a 16:30 dentro de los 10 (diez) día corridos, contados a partir de la última publicación. (expte. 110516).

Única Publicación
27) (Cta. Cte.) 1/p 1354 Ene 25- Ene 25

PUERTO DE MONTEVIDEO

Se hace público que la empresa Solsitur S.A. se presentó ante la Administración Nacional de Puertos, solicitando la renovación del permiso de ocupación del Depósito Nº 20 y su área adyacente en el Puerto de Montevideo, la ANP está dispuesta a acceder al petitorio por el termino de 3 años, por un canon de U$S 60.423 mensuales de conformidad con lo establecido en los art. 50 y 51 del Decreto del Poder Ejecutivo 412/992. Los interesados deberán presentarse por escrito a la Unidad Reguladora de Trámite de la A.N.P. ubicada en el segundo piso del Edificio Sede en el horario de 9:00 a 16:30 dentro de los 10 (diez) día corridos, contados a partir de la última publicación. (expte. 111701).

Única Publicación

27) (Cta. Cte.) 1/p 1353 Ene 25- Ene 25

GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

INTENDENCIAS

INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

Servicio de Geomática
Unidad Nomenclatura y Numeración

De acuerdo a lo que establece el artículo 4to. del Decreto de la Junta Departamental Nº 30.604, promulgado por la resolución Nº 745/04 y Reglamentado por Resolución Municipal Nº 2832/04 de 21 de junio de 2004.-, se intima a los propietarios, de los padrones que se detallan a continuación, frentistas a la calle Ing. Manuel Rodríguez Correa que deben regularizar la numeración de puertas que los identifica actualmente, sustituyéndolos por los números de puerta que la Unidad de Nomenclatura y Numeración, dependiente del Servicio de Geomática, ha establecido para cada uno de ellos:
PADRÓN
* 81125.

Última Publicación

27) (Cta. Cte.) 3/p 1154 Ene 23- Ene 25

Servicio de Geomática
Unidad Nomenclatura y Numeración

De acuerdo a lo que establece el artículo 4to. del Decreto de la Junta Departamental Nº 30.604, promulgado por la resolución Nº 745/04 y Reglamentado por Resolución Municipal Nº 2832/04 de 21 de junio de 2004.-, se intima a los propietarios de los padrones que se detallan a continuación, frentistas a la calle Espuélitas que deben regularizar la numeración de puertas que los identifica actualmente, sustituyéndolos por los números de puerta que la Unidad de Nomenclatura y Numeración, dependiente del Servicio de Geomática, ha establecido para cada uno de ellos:
PADRÓN
* 162271.

Última Publicación

27) (Cta. Cte.) 3/p 1153 Ene 23- Ene 25

VARIOS

"CONSTITUCION DE BIEN DE FAMILIA"

Por Javier Luis Deus Barone.-
Padrón Nº 1.736 zona urbana de Santa Lucia, segunda sección judicial del departamento de Canelones.-
Beneficiarios: Victoria y Jose Ignacio Deus Rodriguez.-
Otorgado el dia 8 de diciembre de 2011.

27) (Sin Costo) 10/p 822 Ene 17- Ene 30

Sociedades Anónimas y Balances

RINQUE S.A.

Contrato: 17/01/2012
Inscripción Nro.: 908 el 23/01/2012
Capital: $ 200.000
200.000 acciones de $ 1
Objeto: A) Industrializar y comercializar en todas sus formas, mercaderías, arrendamientos de bienes, obras y servicios, en los ramos y anexos de: alimentación, artículos del hogar y oficina, automotriz, bar, bazar, caucho, construcción, cosmética, cueros, editorial, electrónica, electrotecnia, enseñanza, espectáculos, ferretería, fotografía, fibras, frutos del país, hotel, imprenta, informática, joyería, juguetería, lana, lavadero, librería, limpieza, madera, máquinas, mecánica, metalurgia, música, obras de ingeniería, óptica, papel, perfumería, pesca, plástico, publicidad, servicios profesionales, técnicos y administrativos, tabaco, textil, turismo, vestimenta, veterinaria, vidrio. B) Importaciones, exportaciones, representaciones, comisiones y consignaciones. C) Compra, venta, arrendamiento, administración, construcción y toda clase de operaciones con bienes inmuebles, excepto inmuebles rurales. D) Participación, constitución o adquisición de empresas que operen en los ramos pre-indicados. Todo lo dispuesto en el presente artículo, es en tanto no contravenga las disposiciones legales específicas vigentes.
Plazo: 100 años
Domicilio: Montevideo.

Única Publicación

28) $ 3536 1/p 1389 Ene 25- Ene 25

ADVENIO S.A.

Contrato: 19/01/2012
Inscripción Nro.: 910 el 23/01/2012
Capital: $ 40.000
40.000 acciones de $ 1
Objeto: A) Industrializar y comercializar en todas sus formas, mercaderías, arrendamientos de bienes, obras y servicios, en los ramos y anexos de: alimentación, artículos del hogar y oficina, automotriz, bar, bazar, caucho, construcción, cosmética, cueros, editorial, electrónica, electrotecnia, enseñanza, espectáculos, ferretería, fotografía, fibras, frutos del país, hotel, imprenta, informática, joyería, juguetería, lana, lavadero, librería, limpieza, madera, máquinas, mecánica, metalurgia, música, obras de ingeniería, óptica, papel, perfumería, pesca, plástico, publicidad, servicios profesionales, técnicos y administrativos, tabaco, textil, turismo, vestimenta, veterinaria, vidrio. B) Importaciones, exportaciones, representaciones, comisiones y consignaciones. C) Compra, venta, arrendamiento, administración, construcción y toda clase de operaciones con bienes inmuebles, excepto inmuebles rurales. D) Participación, constitución o adquisición de empresas que operen en los ramos pre-indicados. Todo lo dispuesto en el presente artículo, es en tanto no contravenga las disposiciones legales específicas vigentes.
Plazo: 100 años
Domicilio: Montevideo.

Única Publicación

28) $ 3536 1/p 1385 Ene 25- Ene 25

VIDAMAX S.A.

$ 60.000
100 AÑOS
MONTEVIDEO
Industrializar, comercializar: mercaderías, arrendamiento de bienes, obras, servicios: alimentación, hogar, oficina, automotriz, bar, bazar, caucho, construcción, cosmética, cueros, editorial, electrónica, electrotecnia, enseñanza, espectáculos, ferretería, fotografía, fibras, frutos del país, hotel, imprenta, informática, joyería, juguetería, lana, lavadero, librería, limpieza, madera, máquinas, mecánica, metalurgia, música, obras de ingeniería, óptica, papel, perfumería, pesca, plástico, publicidad, química, servicios profesionales, técnicos, administrativos, tabaco, textil, turismo, valores mobiliarios, vestimenta, veterinaria, vidrio. Importaciones, exportaciones, representaciones, comisiones, consignaciones. Compraventa, arrendamiento, administración, construcción, operaciones con inmuebles, excepto rurales. Participación, constitución, adquisición empresas operen ramos preindicados.
Inscripción 16/01/2012 Nº 609.

Única Publicación

28) $ 2210 1/p 1372 Ene 25- Ene 25

"CONSORCIO Deloitte-One Tree"

Constitución: 28/12/2011, Montevideo.-
Integrantes: "Deloitte SC" e "Ipicnet SA".-
Objeto: Prestación de Servicios de Consultoria para desarrollo e implantación del Portal Institucional del MIEM.
Duración: Caducará con la completa terminación de los trabajos de Consultoria, o por rescisión de contrato u otra causa con base legal.-

Domicilio: Montevideo.-
INSCRIPCION: 30/12/2011, Nº 21212.
Única Publicación
28) $ 1326 1/p 1368 Ene 25- Ene 25

REFORMAS

C. STEINWEG HANDELSVEEM (LATIN AMERICA) S.A.

Asamblea fecha: 05/10/2011.
Aumento de capital a: $ 70.000.000.- (pesos uruguayos setenta millones).
Registro: 14/11/2011, Nº 18241.
Única Publicación
28) $ 884 1/p 1371 Ene 25- Ene 25

"FOOD & WOOD RESPONSIBLE INVESTMENT S.A." (antes "ILMESTAR S.A.")

Asamblea: 25/02/2011.
Registro: 21213 (30/12/2011).
Modifica:
Art. 1. Denominación.
Art. 3. Capital y Acciones. Será de 100.000 dólares americanos formado por títulos de acciones nominativas de 1 dólar americano cada una.
Única Publicación
28) $ 884 1/p 1365 Ene 25- Ene 25

SEDILER SOCIEDAD ANONIMA en lo sucesivo: LICENCIAS ON LINE S.A.

Asamblea del 28.11.2011
Modifica los artículos 1 y 5 del estatuto
CAPITAL: $ 5.000.000
Inscripción: 23.1.2012, No. 890.
Única Publicación
28) $ 884 1/p 1349 Ene 25- Ene 25

RELMID S.A. Reforma

Por Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 30 de junio de 2011, se resolvió modificar el Art. 3º de sus estatutos. ARTICULO 3º. CAPITAL Y ACCIONES: El capital formado por títulos de una o más acciones al portador de $ 1 cada una, será de $ 20.000.000.-
Inscripción: Nº 655 el 17/01/2012.
Única Publicación
28) $ 1326 1/p 1312 Ene 25- Ene 25

ADENDA COMPROMISO DE FUSIÓN Art. 126 LEY 16.060 LINONPRIDE S.A. y INVERSORA TORONTO S.A. FUSIÓN POR ABSORCIÓN.

SOCIEDAD INCORPORANTE: LINONPRIDE S.A., QUE CAMBIA RÉGIMEN JURÍDICO A LA LEY 16.060
SOCIEDAD A DISOLVER POR INCORPORACIÓN: INVERSORA TORONTO S.A.
CAPITAL DESPUÉS DE LA FUSIÓN: $ 6.003.000
ACREEDORES: COMPROMISO Y BALANCE EN: ITUZAINGÓ No 1393/401 (MONTEVIDEO) de 10:00 a 17:00 HORAS DE LUNES A VIERNES.
28) $ 17680 10/p 1288 Ene 24- Feb 06

LEINSTER S.A.

Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 19/04/04 resolvió reducir el capital integrado a U$S 2.897.649,87.- (dólares estadounidenses dos millones ochocientos noventa y siete mil seiscientos cuarenta y nueve con 87/100). Documentación en Juncal 1327, Unidad 2201. Se convoca a los interesados por un plazo de 30 días.
28) $ 13260 10/p 1213 Ene 23- Feb 03

LEINSTER S.A.

Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 18 de junio de 2004 resolvió reducir el capital integrado a U$S 10.305,32.- (dólares estadounidenses diez mil trescientos cinco con 32/100). Documentación en Juncal 1327, Unidad 2201. Se convoca a los interesados por un plazo de 30 días.
28) $ 13260 10/p 1212 Ene 23- Feb 03

ERNABELLA S.A.

Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 14 de julio de 2009 resolvió reducir el capital integrado a R$ 7.320.108,68 (Reales siete millones trescientos veinte mil ciento ocho con 68/100). Documentación en Juncal 1327, Unidad 2201. Se convoca a los interesados por un plazo de 30 días.
28) $ 13260 10/p 1210 Ene 23- Feb 03

ERNABELLA S.A.

Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 30 de noviembre de 2011 resolvió reducir el capital integrado a R$ 6.771.179,47 (Reales seis millones setecientos setenta y un mil ciento setenta y nueve con 47/100). Documentación en Juncal 1327, Unidad 2201. Se convoca a los interesados por un plazo de 30 días.
28) $ 13260 10/p 1209 Ene 23- Feb 03

CAÇAPAVA S.A.

Asamblea: 19.12.2011
Capital Integrado: $ 84.242.486
Documentación: Rincón 468 piso 4
Plazo: 30 días desde la última publicación.
28) $ 4420 10/p 995 Ene 19- Feb 01

PARAJE GAVIOTAS S.A. Reducción de capital arts. 290, 291 Ley 16.060

AGE: 30/11/2011
Capital rescatado: $ 3.941.400.-
Documentación a disposición en Treinta y Tres 1271.
Interesados: Deducir oposiciones dentro de treinta días de la última publicación.
28) $ 8840 10/p 746 Ene 13- Ene 26

Cantidad de avisos de fecha 25/01/2012 publicados en esta edición: 70.

Tarifas Vigentes a partir del 6 de Junio de 2011

Precios con I.V.A. 22% incluido (*)

SECCIÓN AVISOS

PUBLICACIONES GENERALES *TARIFA ([1])*

Apertura de Sucesiones – Procesos Sucesorios..$ 59.00 (*)
Se publican a texto completo, si se emplaza por un plazo diferente a 30 o 90 días, si hay un emplazamiento específico a persona/s o si se trata de una herencia yacente.

Disolución y Liquidación de Sociedades Conyugales.............................$ 81.00 (*)
Se publican a texto completo las que se efectúan "bajo beneficio de emolumento", (Art. 2014 Código Civil). Tal condición debe constar en el texto del aviso.

Convocatorias, Dirección de Necrópolis, Emplazamientos, Expropiaciones, Licitaciones, Llamado a Acreedores, Pago de Dividendos, Procesos Concursales, Prescripciones, Niñez y Adolescencia, Disoluciones de Sociedades Comerciales (excepto S.A y SRL)..$ 71.00 (*)

Avisos Varios ....$ 81.00 (*)

Venta de Comercios..$ 57.00 (*)

Remates..$ 65.00 (*)

Divorcios, Incapacidades, Información de Vida y Costumbres, Segundas Copias, Unión Concubinaria..$ 30.00 (*)

Sociedades de Responsabilidad Limitada y Sociedades Anónimas (Estatutos, Reformas,
Consorcios y Disoluciones) ....$ 442.00 (*)

TARIFA ([2])

Balances..$8.694.00 (*)

PUBLICACIONES BONIFICADAS *TARIFA ([1])*

Propiedad Literaria y Artística (Decreto 154/004, art. 9)..........................$ 40.00 (*)

Estatutos de Cooperativas (50% de tarifa de Avisos de Sociedades Anónimas)..$ 221.00 (*)

PUBLICACIONES EXTRACTADAS *TARIFA FIJA*

Apertura de Sucesiones – Procesos Sucesorios (10 pub.)........................$ 2.360.00 (*)
De acuerdo con lo dispuesto por los Arts. 3º y 4º de la Ley 16.044, se publica un extracto del edicto judicial conteniendo: nombre de los autos sucesorios, ficha y año, lugar, fecha y actuario.

Disolución y Liquidación de Sociedades Conyugales (10 pub.).........$ 4.050.00 (*)
En cumplimiento de los artículos 3º, 4º y 5º de la Ley 16.044, se publica un extracto del edicto judicial conteniendo: nombre de los cónyuges, ficha , año, lugar, fecha y actuario.

Edictos de Matrimonio (3 publicaciones).. $ 215.00 (*)
Ley Nº 9.906, art. 3 y art. 92 del Código Civil.

PUBLICACIONES SIN COSTO SEGÚN NORMATIVA

Todos los avisos judiciales donde conste:
- Auxiliatoria de pobreza - Ley Nº 15.982, art. 89.
- Trámite por Defensoría de Oficio o Consultorio Jurídico - Ley Nº 18.078.
Edictos Matrimoniales – In Extremis.
Procesos Concursales - Ley Nº 18.387, art. 21. (no comprende los financiados con créditos a la masa).
Rectificaciones de Partidas - Ley Nº 16.170, art. 340.
Niñez y Adolescencia - Ley Nº 17.823, art. 133 y/o Ley Nº 13.209, art. 2.
Demandas Laborales – Ley Nº 18.572, art. 28.
Varios – Bien de Familia (Ley Nº 15.597, art. 16)

([1]) Precio para el centímetro por columna de 6,2 cm.
([2]) Precio por página.

SECCIÓN DOCUMENTOS

PUBLICACIONES OFICIALES *TARIFA ([3])*

Documentos oficiales (leyes, decretos, resoluciones y otras normas) $ 106.00 (*)

([3]) Precio para el centímetro por columna de 9,5 cm.

PUBLICACIONES ESPECIALES

En los documentos o avisos que, individualmente y por publicación, superen las 10 páginas del Diario Oficial, se aplicará la siguiente tabla de descuentos por tramos, según la tarifa que corresponda:

Tramos	Cantidad equivalente en Cm. de Avisos	Cantidad equivalente en Cm. de Documentos	Descuento
De la pág. 11 a la pág. 20	781 a 1560	521 a 1040	10%
De la pág. 21 a la pág. 30	1561 a 2340	1041 a 1560	20%
De la pág. 31 a la pág. 40	2341 a 3120	1561 a 2080	30%
De la pág. 41 a la pág. 50	3121 a 3900	2081 a 2600	40%
De la pág. 51 en adelante	3901 en adelante	2601 en adelante	50%

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA PUBLICACIÓN

-Formato de la caja de cada página, 19,5 x 26 cm.
-La Sección Avisos se diagrama a tres columnas de 6,25 cm.
-La Sección Documentos se diagrama a dos columnas de 9,5 cm.
-El tipo de letra utilizado es Times, cuerpo 9 o Palatino, cuerpo 8.7. El interlineado es 9,5.

ACLARACIONES DE LA PUBLICACIÓN DE LOS AVISOS Y DOCUMENTOS

- Las publicaciones se realizarán en un plazo de hasta 48 horas de recibido el original en IMPO.
- Se respetará fielmente el original recibido.
- Al momento de recibir el material a publicar, IMPO se reserva el derecho de no publicar avisos o documentos que por su presentación no sean legibles, se encuentren incompletos, presenten incongruencias o no cumplan con la normativa vigente.
- Los edictos deberán estar convalidados por el sello de la Sede y la firma del Juez o Actuario, y no podrán contener enmiendas, tachaduras o agregados que no estén debidamente salvados por el firmante (Circular 32/2006 de la SCJ).
- IMPO determinará la ubicación donde deban publicarse los avisos o documentos recibidos.
- IMPO podrá exigir la presentación en medio magnético de los originales que sean extensos.



Tarifas Vigentes a partir del 6 de Junio de 2011

Precios con I.V.A. 22% incluido (*)

OTRAS TARIFAS

EJEMPLARES

Del día	De más de 15 días	De más de un año
$ 30	$ 48	$ 94

SUSCRIPCIONES DE EJEMPLARES

TIPO	Mensual	Semestral	Anual
Con retiro en IMPO	$ 603	$ 3.400	$ 6.648
Interior del País	$ 682	$ 3.839	$ 7.507
Exterior del País	$ 1.450	$ 8.387	$ 16.401

FOTOCOPIAS CERTIFICADAS

Página de Sección Avisos .... $ 25 (*)
Página de Sección Documentos .... $ 10 (*)

ACCESO A BASE DE DATOS

El minuto (a través del 09002044) .... $ 8.93 (*)

SUSCRIPCIÓN AL DIARIO EN LÍNEA

Diario Oficial en línea Completo.
Precio, según modalidad, con derecho a acceder a treinta y cinco ediciones de Diario Oficial en el mes.

MODALIDAD	Mensual	Semestral	Anual
1 Usuario	$ 410	$ 2.309	$ 4.512
2 Usuarios	$ 697	$ 3.922	$ 7.666
3 a 4 Usuarios – POR USUARIO	$ 304	$ 1.710	$ 3.342
5 a 10 Usuarios – POR USUARIO	$ 276	$ 1.550	$ 3.029
Más de 10 Usuarios – POR USUARIO	$ 240	$ 1.352	$ 2.642

Sección Documentos del Diario Oficial en línea.
Precio, según modalidad, con derecho a acceder a treinta y cinco ediciones de Diario Oficial en el mes.

MODALIDAD	Mensual	Semestral	Anual
1 Usuario	$ 400 (*)	$ 2.271 (*)	$ 4.439 (*)
2 Usuarios	$ 687 (*)	$ 3.896 (*)	$ 7.613 (*)
3 a 4 Usuarios – POR USUARIO	$ 301 (*)	$ 1.705 (*)	$ 3.331 (*)
5 a 10 Usuarios – POR USUARIO	$ 264 (*)	$ 1.496 (*)	$ 2.924 (*)
Más de 10 Usuarios – POR USUARIO	$ 237 (*)	$ 1.341 (*)	$ 2.621 (*)

Sección Avisos del Diario Oficial en línea
Precio, según modalidad, con derecho a acceder treinta y cinco ediciones de Diario Oficial en el mes.

MODALIDAD	Mensual	Semestral	Anual
1 Usuario	$ 278 (*)	$ 1.564 (*)	$ 3.056 (*)
2 Usuarios	$ 480 (*)	$ 2.698 (*)	$ 5.273 (*)
3 a 4 Usuarios – POR USUARIO	$ 207 (*)	$ 1.166 (*)	$ 2.279 (*)
5 a 10 Usuarios –POR USUARIO	$ 186 (*)	$ 1.044 (*)	$ 2.041 (*)
Más de 10 Usuarios – POR USUARIO	$ 166 (*)	$ 933 (*)	$ 1.823 (*)

SERVICIO PERSONALIZADO DE BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN.

Consiste en brindar información vinculada a una temática en particular, según requerimiento del usuario, tematizada y relacionada. Se determinará el valor del servicio de acuerdo con el alcance de la información solicitada.

SERVICIO DE EDICIÓN DE PRODUCTO EDITORIAL.

Consiste en compilar y editar normas o publicaciones relacionadas y actualizadas.
El valor del servicio será determinado por la Dirección de IMPO, en base al alcance del trabajo y de sus requerimientos técnicos.

La energía es una oportunidad

Por Dr. Ramón Méndez – Director Nacional de Energía

Uruguay es un país sin energéticos «tradicionales». No posee, al menos que sepamos, reservas probadas de petróleo, gas natural o carbón, fuentes no renovables, pero que en conjunto, representan más del 80 % de la energía primaria consumida en el mundo. Al mismo tiempo, ha colmado sus posibilidades de aprovechamiento de la energía hidroeléctrica. Esta dificultad llevó a que, en nuestra cultura reciente, la palabra «energía» fuera usualmente utilizada junto a expresiones como «problema», «dificultad», o incluso la más sombría «crisis».

Paralelamente, durante los últimos años, nuestro país ha venido creciendo de manera sostenida, a un ritmo inédito en su historia. Esta situación demanda cada vez más energía, tanto para satisfacer las necesidades de la industria, como las del transporte o del sector residencial.

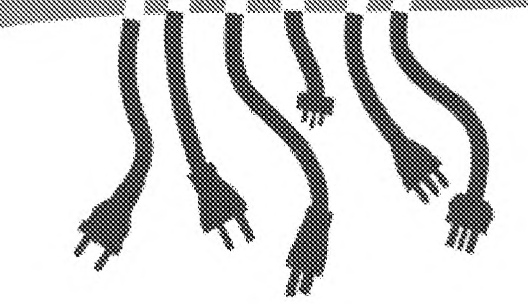
En este contexto particularmente complejo, luego de un profundo análisis, en 2008 el Consejo de Ministros aprobó una Política Energética con una mirada de largo plazo. Esta política está basada en cuatro grandes ejes estratégicos, metas de corto, mediano y largo plazo (que deberán cumplirse antes de 2015, 2020 y 2030, respectivamente), así como un conjunto de varias decenas de líneas de acción que garantizarán que los objetivos se alcancen en tiempo y forma. Los ejes estratégicos definen el rol de los diferentes actores a la vez que puntualizan el papel del Estado para diseñar y conducir la política energética, la diversificación de la matriz energética con especial énfasis en las energías renovables, el impulso de la eficiencia energética y la consideración del acceso adecuado a la energía como un derecho humano para todos los sectores sociales.

Dos años más tarde, durante la transición entre el Gobierno anterior y el actual, el entonces presidente electo, José Mujica, propuso a la oposición la creación de cuatro comisiones multipartidarias para analizar otros tantos grandes temas nacionales. Uno de ellos fue el energético. En esta comisión, los partidos con representación parlamentaria avalaron, en su esencia, la política vigente. Desde 2010, por lo tanto, Uruguay posee una política energética de largo plazo, acordada por todos los sectores políticos.

Uno de los pilares de esta política de Estado es el aprovechamiento de fuentes energéticas no tradicionales que nuestro país no usufructuaba. Entre otras, las energías eólica y solar, los diversos usos de los residuos de biomasa de los emprendimientos agroindustriales y forestales, así como los biocombustibles presentan en nuestro país ventajas comparativas superlativas. En Uruguay, las energías renovables permiten no solo reducir costos sino también generar mayor soberanía al independizarnos de la importación de energéticos cuyo precio, en el mercado mundial, no podemos controlar.

Como consecuencia de estas políticas, ya en 2010 la participación de las energías renovables en nuestra matriz energética llegó al 48 %, lejos del 10 % que es el promedio mundial, y de la meta del 20 % que se planteó la Unión Europea para 2020.

En suma, en unos pocos años, en Uruguay hemos demostrado que la energía, lejos de ser un eterno «problema», puede visualizarse como una «oportunidad» para contribuir al desarrollo de nuestro país y permitir la inclusión social de sus ciudadanos.





La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas ha proclamado el año ***2012: Año Internacional de la Energía sostenible para todos.***

> La ONU [...] alienta a todos los Estados Miembros, al sistema de Naciones Unidas y a todos los demás agentes a que aprovechen el Año Internacional para concienciar sobre la importancia de abordar los problemas energéticos, en particular los servicios energéticos modernos para todos, el acceso a servicios de energía asequibles, la eficiencia energética y la sostenibilidad de las fuentes y del uso de la energía, con el fin de alcanzar los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente, incluidos los objetivos de Desarrollo del Milenio, y asegurar el desarrollo sostenible y la protección del clima mundial [...]

La Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales (IMPO) suscribe esta declaración en todos sus términos y ha decidido aprovechar esta valiosa oportunidad para trabajar en la toma de conciencia sobre la importancia de incrementar el acceso sostenible a la energía renovable, en el ámbito nacional. Dado que los servicios energéticos son fundamentales en la productividad, la salud, la educación, los servicios de comunicación y finalmente en el cambio climático dedicaremos, durante todo el 2012 —en coordinación con la Dirección de Energía del Ministerio de Industria, Energía y Minería— espacios en las tapas y contratapas del Diario Oficial, en la Pantalla Gigante y en nuestro Portal Web IMPO, además de la promoción de foros sobre el tema, en nuestra sala de eventos.

más información, más ciudadanía

Texto de contratapa: Sra. Margarita Echevestre
Diseño de tapas y retiros: Lic. Marcelo Calafat